未来は光でおもしろくなる

USHIO

新成長戦略 Revive Vision 2030

ウシオ電機株式会社　PRIME | 6925

2024.5.14

Index

USHIO

第1章	新成長戦略の全体像	P3
第2章	前中期経営計画の振り返り ▶前中期経営計画の振り返りについては、P38～42に補足資料を掲載	P8
第3章	新成長戦略「Revive Vision 2030」の具体的な施策 概略 P14 / 事業戦略 P17 / 財務戦略 P27 ▶事業戦略については、P43～52に補足資料を掲載	P13
第4章	ESGへの取り組み ▶ESGへの取り組みについては、P53～55に補足資料を掲載	P33
Appendix	前中期経営計画の振り返り　補足	P38
	事業戦略　補足	P43
	ESGへの取り組み　補足	P53

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

第1章

新成長戦略の全体像

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

中期経営計画の見直しの背景

半導体市況の変化

サーバーやパソコン関係の市場停滞が
長期化したことなどを背景に、
当社を取り巻く半導体の市況環境が大きく変化

他社光源の台頭

EUVマスク検査用光源で他社光源が
台頭し戦略変更が生じた

Industrial Process事業の大きな事業環境変化を受けて

戦略を見直し

「新成長戦略：Revive Vision 2030　策定」

「Revive Vision 2030」の「Revive」は「大きな変革をもって、目指す姿を実現する」という当社の想いを表現したものです。

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

2030年の目指す姿

USHIO

Mission

光を「あかり」としてだけではなく、「エネルギー」として利用することで
社会課題や世の中の技術革新に貢献する

Vision

「光」のイノベーションカンパニー

インダストリアルプロセス領域を主体にお客様とともに成長する

Industrial Process (IP)

**光加工技術を通じ、便利で快適な
社会基盤づくりを支える領域**

モノづくりプロセス

半導体、電子デバイス、EV、建材・印刷など

Visual Imaging (VI)

**映像・照明技術を通じ、
人々に感動・共有を提供する領域**

エンターテインメント空間の大型映像演出・運営

（テーマパーク、映画館、イベントなど）

公共施設、企業の管制室、映像システム

Photonics Solution (PHS)

**フォトニクス技術を通じ、社会の発展に
貢献する価値を顧客と共創し提供する領域**

半導体関連製造装置用

レーザーシネマやAR/VRでの組み込み採用

遺伝子シーケンスや眼科・内科などの医療検査

Life Science (LS)

**光技術を応用し、地球と人々の
安心・安全を支える領域**

健康寿命の延伸（環境衛生、ヘルスケア、製薬、創薬）

人を取り巻く環境の改善・保全に貢献

疾病の原因となる条件を除去し、健康の保持に貢献

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

Revive Vision 2030で目指すもの

USHIO

係数目標

Phase Ⅰ（~FY26）

ROE **8** %以上

※前中計の１年遅れ

（早期に**PBR１倍超**を達成）

Phase Ⅱ（~FY30）

ROE **12**%以上

参考：営業利益率 **12**%以上

方針

経営効率を重要視した成長戦略

成長・開発投資、リソースを
IP事業に集中
成長拡大

×

“率”を追求

×

成長投資と資本効率
を両立

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

Revive Vision 2030で目指すもの

USHIO

実効性の高い
事業戦略 / 財務戦略

事業戦略

- ポートフォリオ変革の実行（不採算事業のてこ入れ）
- 半導体アドバンスドパッケージ事業の成長拡大

財務戦略

- 資本最適化
- 財務規律を重視した経営を推進かつ資産効率を改善
- 有価証券の売却による金融資産から事業資産への振り替え加速

Phase Ⅰ
（FY24～FY26）

事業戦略： 戦略分野の再定義による「事業ポートフォリオ変革」を実施

財務戦略： 自社株投資＋配当で650～750億円規模を実施しROE8%以上を達成

Phase Ⅱ
（FY27～FY30）

事業戦略： Phase Ⅰでの成果を最大限発揮し「事業の着実な成長」を実現

財務戦略：機動的な自社株投資を実施し、自己資本は2,000億円以下を維持

「成長投資」を中心としたキャッシュアロケーションの実現

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

第2章

前中期経営計画の振り返り

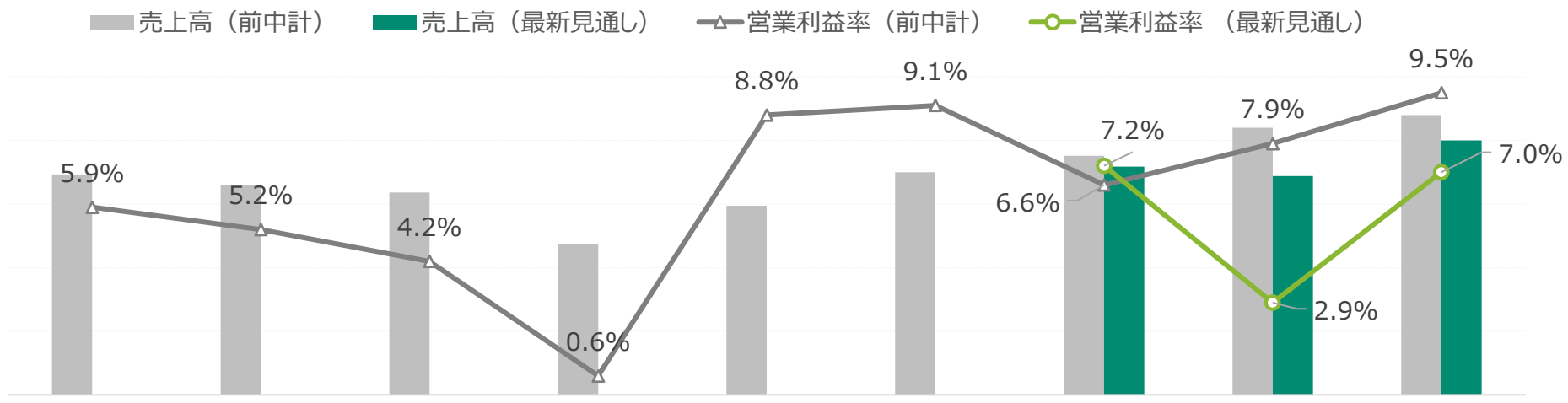
Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

見通しの修正①

USHIO

事業環境に大きな変化が生じ、2024年度は業績が低迷。前中計最終年度(2025年度)は回復基調も未達の見通しに

前中計の進捗と最新見通し



億円	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
売上高（前中計）	1,734	1,651	1,590	1,185	1,488	1,750	1,880	2,100	2,200
（最新見通し）*							**1,794**	**1,750**	**2,000**
営業利益率（前中計）	5.9%	5.2%	4.2%	0.6%	8.8%	9.1%	6.6%	7.9%	9.5%
（最新見通し）*							**7.2%**	**2.9%**	**7.0%**

*FY23の数値は実績値

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

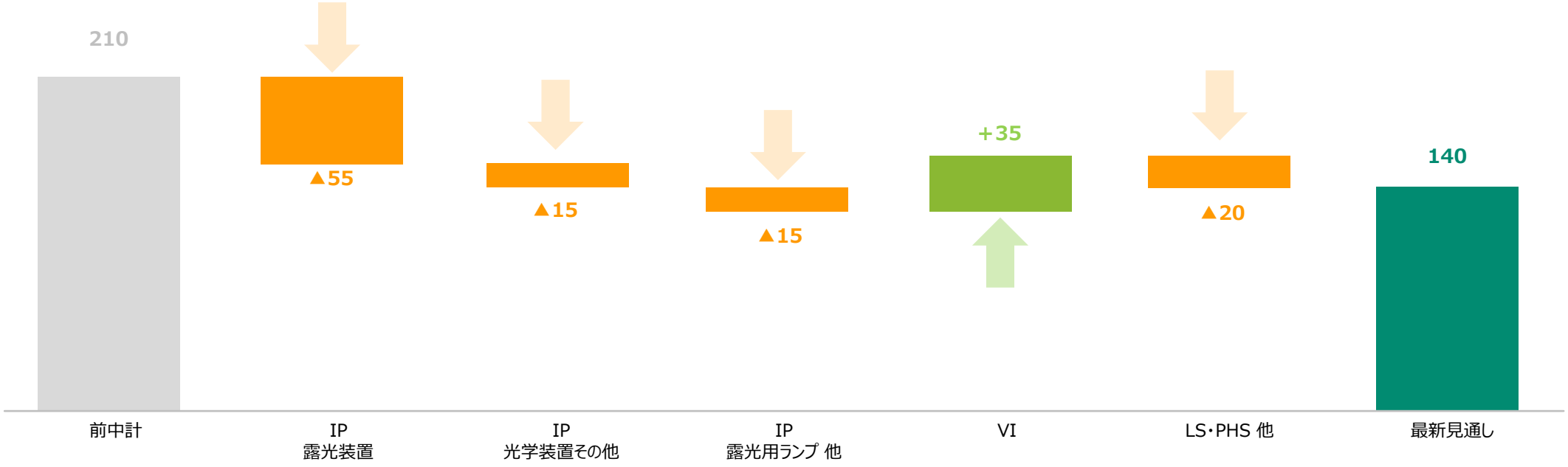
見通しの修正②

USHIO

前中計最終年度(2025年度)は将来を見据えた成長投資拡大の計画も、IP事業で露光装置やEUV光源の売上高が大幅未達の見込み。VI事業は増益見込みもカバーしきれず、結果として、前中計から営業利益で約70億円の未達の見込みに

前中計と最新見通しの営業利益

（FY25 営業利益：億円）



Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

見通し修正に至った要因

USHIO

外部要因

半導体製造装置の市場動向と PCパッケージ基板市場の急減速

2023年度1Qに入り大幅な市況ダウン。
後工程関連装置メーカー各社におけるマイナス成長見通し

▶ 詳細 appendix P39

AMAT社*との業務提携

AMAT社との業務提携での露光装置
フルラインアップ化による新たな成長可能性

▶ 詳細 P24-25

内部要因

① 成長事業における主要顧客層への依存

PC需要の急減速やサーバー需要における
各社シェアの変動により、主要顧客層への依存度
の高さが影響し、見通しの大幅な修正が必要に

▶ 詳細 appendix P40

② EUV競争環境変化

他社光源の台頭により
見通しの修正が必要に

▶ 詳細 appendix P41

③ 不採算事業の影響

不採算事業における
収益向上策の不調

▶ 詳細 appendix P42

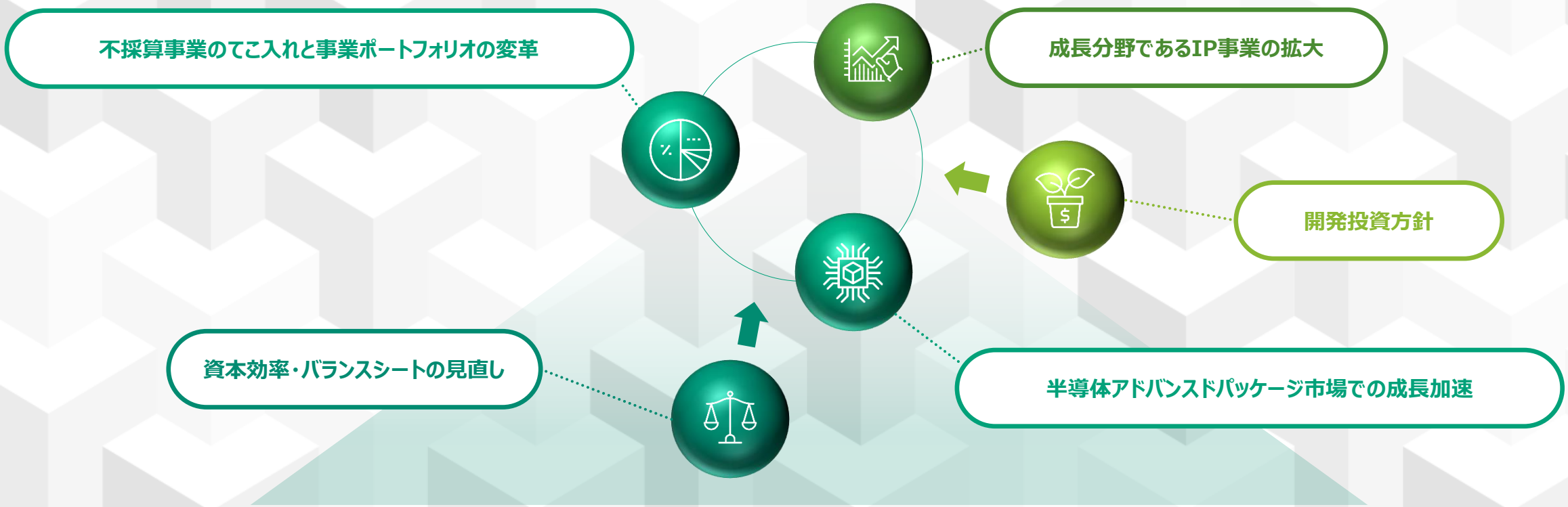
＊ AMAT社：Applied Materials, Inc（アプライド マテリアルズ社）の略称。以降のページ同様

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

重要課題を踏まえた新成長戦略「骨子」

USHIO

見通しの修正に至った外部・内部要因を踏まえ、新成長戦略骨子を策定
戦略重点分野の更なる強化を図り、事業ポートフォリオの変革を進めること、
計画の厳格なモニタリングを実施することで、より実現可能性の高い企業価値向上シナリオへ



Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

第3章

新成長戦略「Revive Vision 2030」の具体的な施策

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

Revive Vision 2030 の位置づけ

「ボリュームの追求」から「率の追求」へ

戦略領域に投資を集中し成長基盤を確立するとともに、Phase Ⅰ でROE8%以上、早期のPBR 1 倍超を実現

Revive Vision 2030

FY2020 — FY2021 — FY2022 — FY2023 — FY2024 — FY2025 — FY2026 — FY2027 — FY2028 — FY2029 — FY2030

Revive Vision 2030 Phase Ⅰ [FY2024～FY2026]

Revive Vision 2030 Phase Ⅱ [FY2027～FY2030]

第1次中計 [FY2020～FY2022]

第2次中計 [FY2023～FY2025]

計画が大幅乖離し
成長戦略を抜本的に見直し

1次中計
体質改善を図る
業績実績（FY2022）
ROE：5.7%
（営業利益率：9.1%）
売上高：1,750億円

2次中計
成長を仕込む
業績目標（FY2025）
ROE：8 %以上
（営業利益率：9.5%）
売上高：2,200億円

新成長戦略 Phase Ⅰ
事業ポートフォリオの変革
戦略分野の再定義による
「事業ポートフォリオ変革」を実施
業績目標（FY2026）
ROE*：8 %以上
（参考値）
営業利益率*：10%以上
売上高：2,000億円

新成長戦略 Phase Ⅱ
事業の着実な成長
Phase Ⅰ の成果を最大限活用
最終年度業績目標（FY2030）
ROE*：12 %以上
（参考値）
営業利益率*：12%以上
売上高：2,000～2,500 億円

*将来の企業価値向上に資するポートフォリオ変革による選択と集中（事業買収や売却・撤退）を行う際に、計画外の一時的業績影響が生じる可能性があります。 その場合は、速やかに開示させていただきます。

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

新成長戦略（PhaseⅠ）の基本方針と概要

戦略分野を再定義し、戦略重点分野の更なる強化を図りながら事業ポートフォリオの変革を進める（選択と集中）

	戦略	PhaseⅠ（FY24～26）の目標
事業戦略	**不採算事業のてこ入れと事業ポートフォリオの変革** ▶ 詳細P17～22	● 経営資源配分の最適化により、Industrial Process事業を中心とした注力事業（領域）へ積極的に投資する一方で、将来性等を鑑みた不採算事業の見極めを進める
事業戦略	**成長分野であるIP事業の拡大** ▶ 詳細P23	● IP事業：売上高　FY23　821億円 →FY26：1,100億円 →FY30：1,400~1,500億円 営業利益率　FY23　13.2% → FY26：14%以上　→　FY30：18～20%
事業戦略	**半導体アドバンスドパッケージ市場での成長加速** ▶ 詳細P24～25	● 成長分野であるIndustrial Process事業において、関連する露光装置を2023年度以降、2030年度までCAGR15%以上で成長拡大させる
事業戦略	**開発投資方針** ▶ 詳細P26	● メリハリのある投資計画へ見直し ● 成長拡大が見込めるインダストリアルプロセス領域への投資を優先し拡大させる ● PHS事業やLS事業（新規事業）は、成長の道筋がより見込める案件に絞り込む
財務戦略	**資本効率・バランスシートの見直し** ▶ 詳細P27～32	● 2026年度にROE8%以上とし、早期のPBR1倍超を目指す ● 自社株投資＋配当で650～750億円の実施を予定。配当は下限配当１株当たり70円とする ● 有価証券を350億円以上圧縮する（PhaseⅡでは150億円以上を計画） ● 自己資本は2,000億円以下とする

FY30の目標値

ROE

12%以上

（参考値）

営業利益率：

12%以上

売上高：

2,000～2,500億円

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

参考値（セグメント別）

単位：億円

セグメント	FY2023実績			Phase Ⅰ（FY2026）		
	売上高	営業利益	営業利益率	売上高	営業利益	営業利益率
IP	821	108	13%	1,100	155	14%
VI	805	58	7%	700	55	8%
LS	52	▲23	▲45%	70	▲10	▲14%
PHS	102	▲15	▲15%	120	3	3%
連結合計*	**1,794**	**129**	**7%**	**2,000**	**200**	**10%**

*連結合計には「その他」セグメントも含む

FY2030 目指したい姿

営業利益率：12%以上
（売上高：2,000～2,500億円）

↑

IP事業を柱とした事業ポートフォリオへ
（IP事業：営業利益率18～20%を目指す）

＋

新規事業（LS事業を含む）を育成

＋

VI・PHSは安定したキャッシュを生み出す事業へ
（将来的に営業利益率12%以上を目指す）

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

ポートフォリオ変革の方向性

不採算事業のてこ入れを行い収益力向上の実現へ
ポートフォリオの変革を実行
（FY2030： 営業利益率 12%以上の実現へ）

ウシオならではの強みが発揮される領域へのシフト	創業からのウシオの文化と強みであるグローバル・ニッチトップの考えのもと、「光」に関わる技術的強みを活かせ、かつ、高い付加価値の提供が可能な領域に絞り込む
投資計画の見直し	メリハリのある投資計画へ見直し
明確な事業評価	加重平均資本コスト(WACC)を見据えたハードルレートの設定による評価を実施 ※WACCの考えはP27参照
注力事業への投資と不採算事業の見極め	経営資源配分の最適化により、注力事業（領域）へ積極的に投資しつつ、将来性等を鑑みた不採算事業の見極めを進める

Industrial Process（IP）事業

注力事業として積極的な投資により成長拡大を加速

- 特に成長拡大が見込める半導体アドバンスドパッケージ領域に投資
- 半導体プロセスなど成長が見込める分野への投資及びEUV事業の戦略見直し

Visual Imaging（VI）事業

収益構造改善と事業の見極めで収益性を改善

Life Science（LS）事業

将来性の見極めを強化し、成長拡大が見込める分野のみへ投資

Photonics Solution（PHS）事業

将来性や強みが発揮できる分野に注力し、縮小と撤退の見極めを進める

※VI・PHS事業については、想定利益率の達成を見据え、常に戦略の再検証を行う

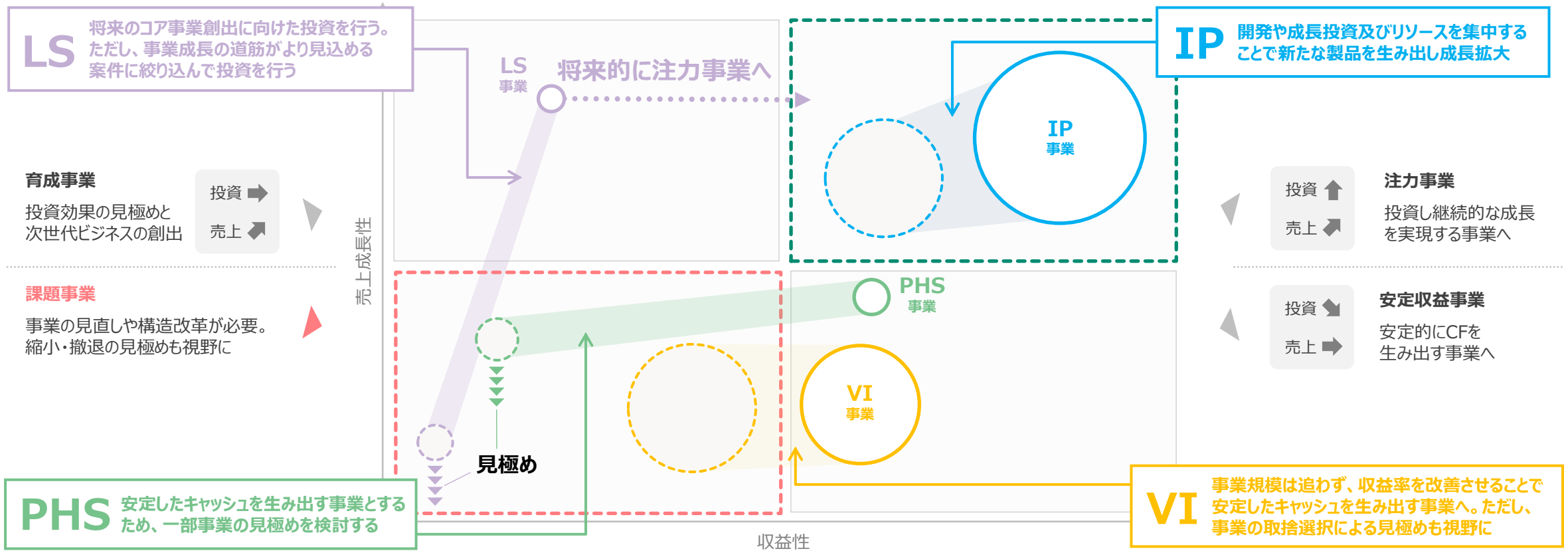
Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

事業ポートフォリオの変革（セグメント全体）

…現在　…2030年の目指す姿

USHIO

注力事業として投資拡大し成長	案件の絞り込みと投資で育成	不採算事業のてこ入れによる安定収益化	
IP事業	LS事業	VI事業	PHS事業



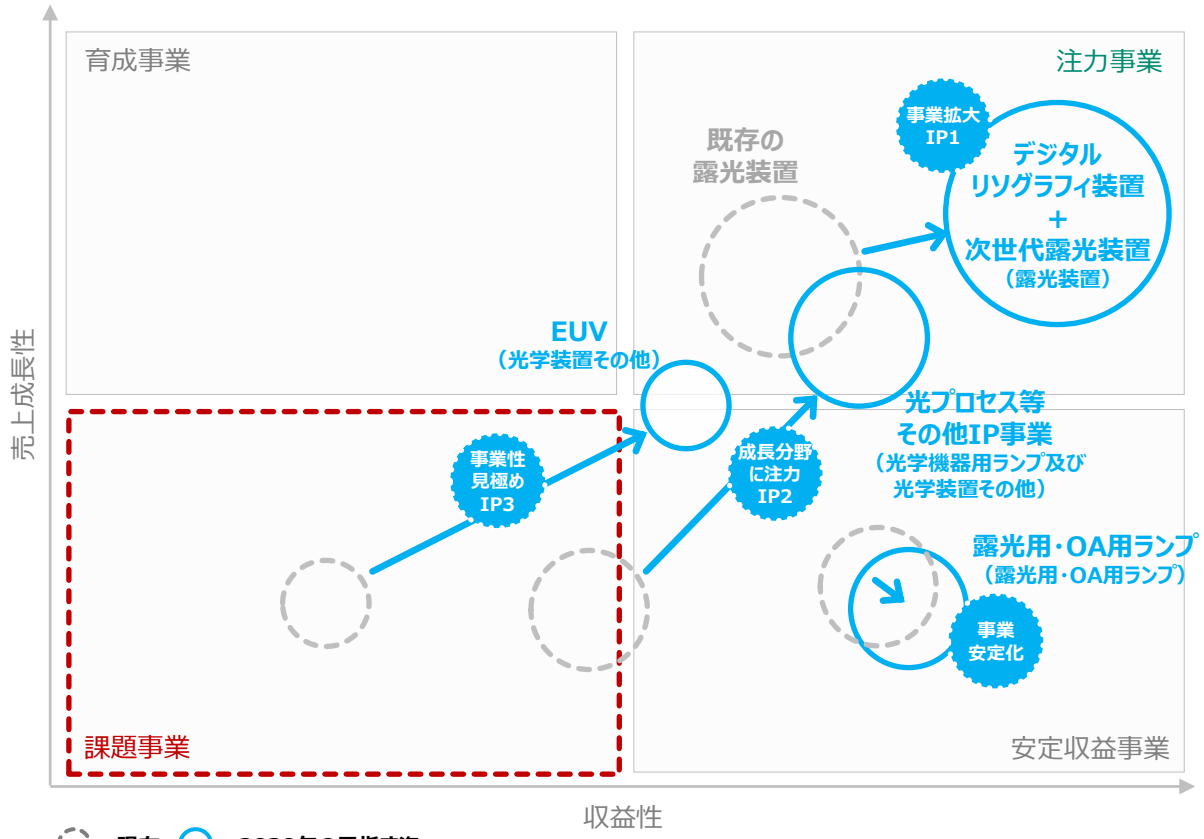
Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

セグメント別ポートフォリオと施策（IP）

開発や成長投資及びリソースを集中することで新たな製品を生み出し成長拡大

IP事業のポートフォリオイメージ



…現在　…2030年の目指す姿

※ポートフォリオイメージ図のバブルチャートの大きさは、事業規模にあわせたものです。事業セグメント毎の規模のイメージはP18を参照ください

具体的な施策

	注力分野（サブセグメント）	施策	開発投資（スライド26）
投資拡大及び継続により成長	IP1 デジタルリソグラフィ装置＊＋次世代露光装置（露光装置）	AMAT社との業務提携案件を中心に開発投資やリソースを集中することで、半導体アドバンスドパッケージ市場でのリーディングカンパニーとなるべく、製品のフルラインアップ化を行う ▶ 詳細P24～25	IP1
	IP2 光プロセス等その他IP事業（光学機器用ランプ及び光学装置その他）	成長が見込める半導体分野に注力し、製品力強化の投資を行いながら事業拡大を目指す ▶ 詳細P45～46	IP2
	IP3 EUV（光学装置その他）	今後のHigh-NAへの参入など、製品開発を継続 ただし、事業性が見込めなくなった場合は、縮小、撤退も検討 ▶ 詳細P47	IP3
安定化	露光用・OA用ランプ（露光用・OA用ランプ）	安定した市場動向をベースに競争力強化のための投資は継続し、安定したキャッシュを生み出す事業として継続 ▶ 露光用ランプ：詳細P48	IP2

将来の成長ドライバー有力候補事業
高度化が進む半導体領域を中心とした検査・分析装置向け市場へ、ウシオの特徴ある様々な光源技術を活用した新たな可能性を追求

＊アプライドマテリアルズ社との業務提携によるDLT(デジタルリソグラフィ技術)搭載のDI露光装置のこと

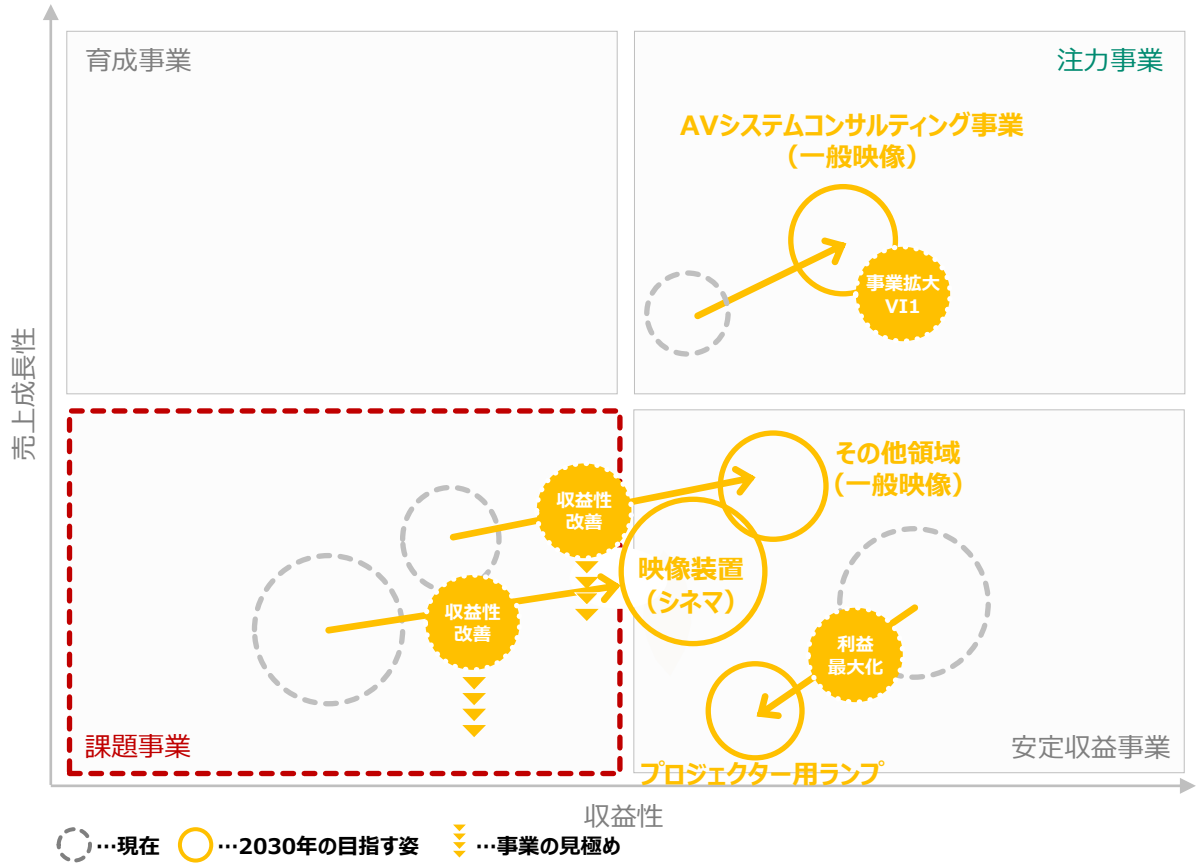
Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

セグメント別ポートフォリオと施策（VI）

事業規模は追わず、収益率を改善させることで安定したキャッシュを生み出す事業へ。ただし、事業の取捨選択による見極めも視野に

VI事業のポートフォリオイメージ



※ポートフォリオイメージ図のバブルチャートの大きさは、事業規模にあわせたものです。事業セグメント毎の規模のイメージはP18を参照ください

具体的な施策

	注力分野（サブセグメント）	施策	開発投資（スライド26）
投資拡大で成長	VI1 AVシステムコンサルティング事業（一般映像）	高付加価値事業であるAVシステムコンサルティング事業に注力 ●リソースを集中し、規模拡大とともに収益拡大を図る ▶ 詳細P50	VI1
投資抑制し安定収益化	その他領域（一般映像）	市場成長は限定的なため、事業規模は追わず収益性の改善・向上に注力 ただし、事業の取捨選択による見極めも視野に ●事業の見極めも選択肢に、選択と集中により収益性の改善を推進	
	映像装置（シネマ）	●リカーリングビジネスや製品に付随するサービス収入の割合増加 ●生産委託等の協業強化により競争力維持のための製品ラインアップ適正化を効率的に行う ▶ 詳細P50	
縮小	プロジェクター用ランプ（プロジェクター用ランプ）	固体光源化で事業縮小 ●シェアを維持・拡大し、かつ、拠点の統廃合や商流改善による経費削減などを優先して行い、利益の最大化を目指す	

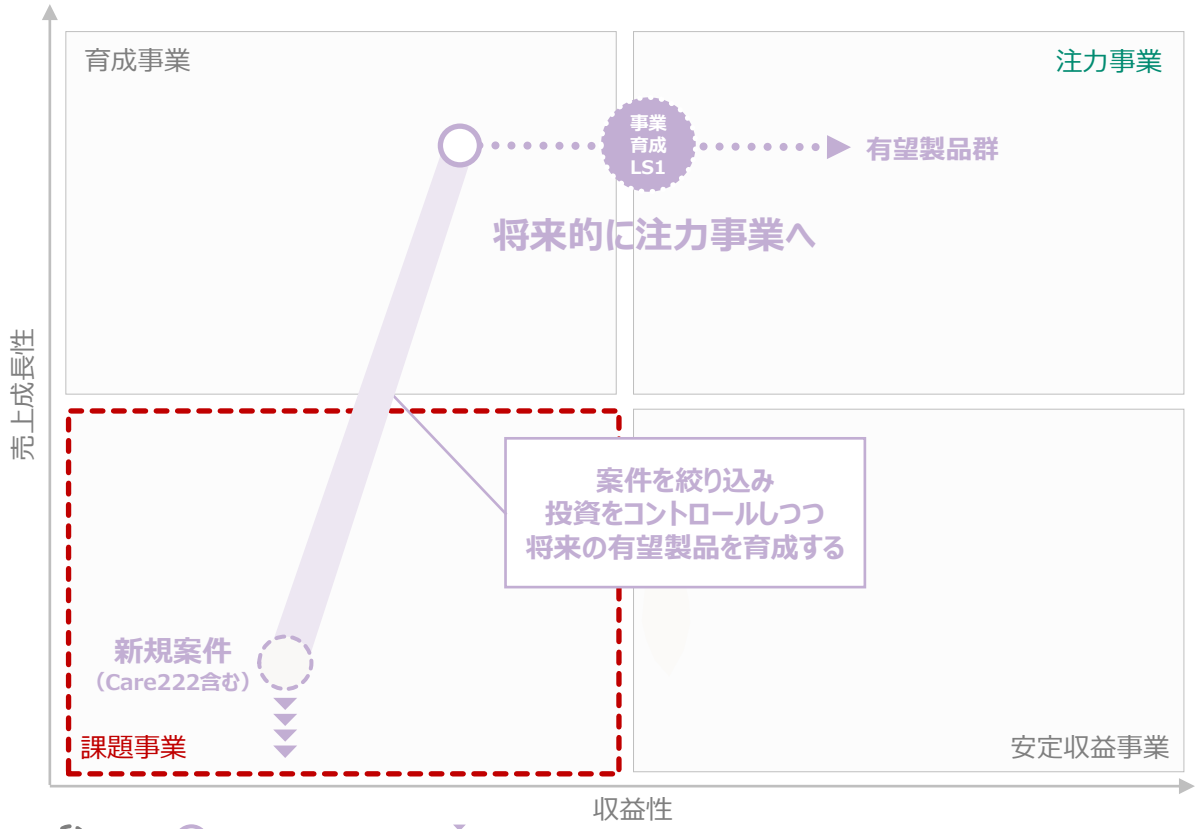
Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

セグメント別ポートフォリオと施策（LS）

将来のコア事業創出に向けた投資を行う。ただし、事業成長の道筋がより見込める案件に絞り込んで投資を行う

LS事業のポートフォリオイメージ



…現在　…2030年の目指す姿　…案件の見極め

※ポートフォリオイメージ図のバブルチャートの大きさは、事業規模にあわせたものです。事業セグメント毎の規模のイメージはP18を参照ください

具体的な施策

	注力分野	施策	開発投資（スライド26）
新規事業の育成	新規案件（Care222含む）	案件の絞り込みにより投資をコントロールしながら、将来の有望製品群の育成を行う	LS1
新規事業の育成	LS1 有望製品群	事業進捗を注視しつつ、投資をコントロールしながら事業拡大を目指す	LS1
安定化	メディカル機器・ヘルスケア事業	需要が安定し一定の収益を生み出している分野については、ラインアップの新陳代謝を継続し安定収益を確保	

有望製品群について

- 特定波長による表面改質技術を活用した生体機能チップへの貢献で創薬の開発課題を解決
- パルス光式新型分光技術により品質検査工程に貢献

Phase Ⅰ　有望提携先との共同開発 → Phase Ⅱ　製造・販売開始見込み

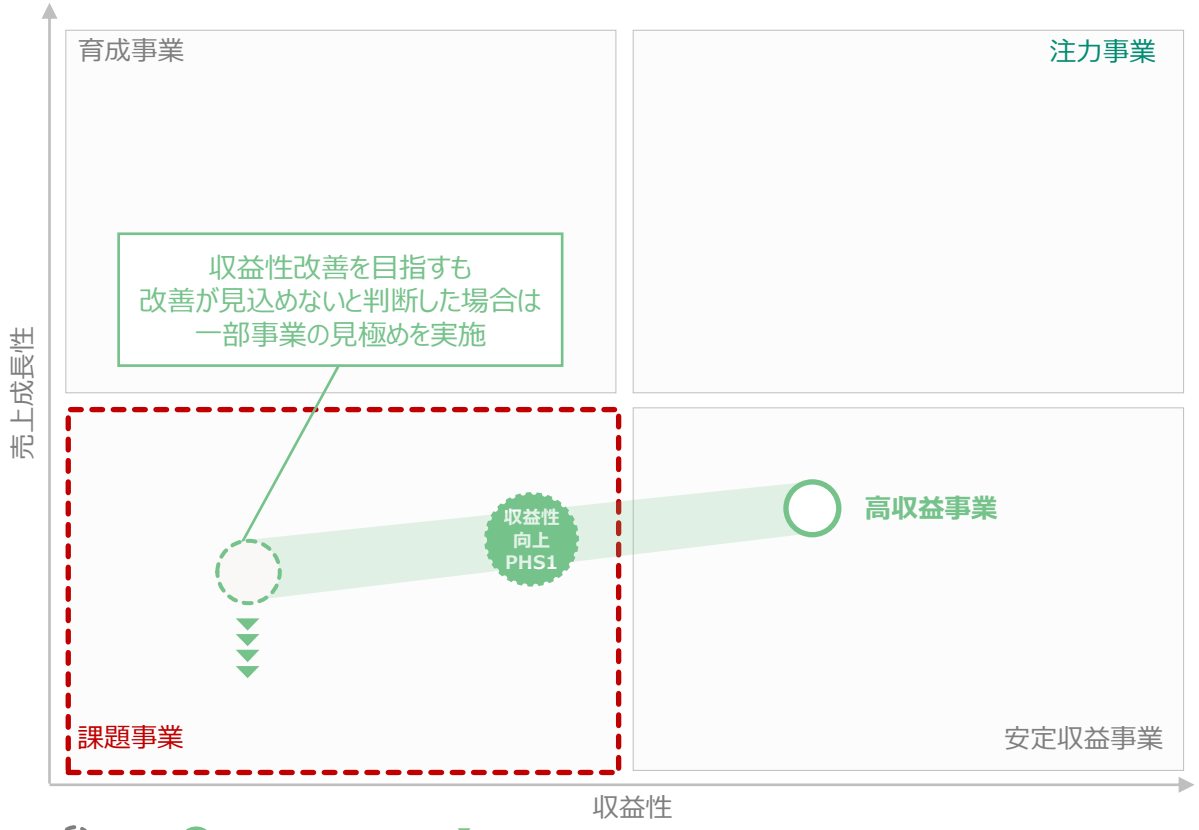
Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

セグメント別ポートフォリオと施策（PHS）

安定したキャッシュを生み出す事業とするため、一部事業の見極めを検討する

PHS事業のポートフォリオイメージ



…現在　…2030年の目指す姿　…事業の見極め

※ポートフォリオイメージ図のバブルチャートの大きさは、事業規模にあわせたものです。事業セグメント毎の規模のイメージはP18を参照ください

具体的な施策

	注力分野	施策	開発投資（スライド26）
見極め	事業の見極め	競争力や成長性が低く、収益改善が見込めない事業は、事業の見極めを行う	
安定化	PHS1 高収益事業	高収益が確保できる事業については、適切な投資により、安定したキャッシュを生み出す事業へ育成	PHS1

高収益事業

- 成長が期待できるメガトレンドに対し、モジュール事業を中心に事業拡大
- 成長領域をリードするキープレイヤーとの協業推進（M&A・提携）

着目しているメガトレンド

半導体、メディカル、AR/VRなど

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

Industrial Process事業の戦略方針

半導体アドバンスドパッケージ事業を柱としてIP事業を成長・強化。リソースを集中し、迅速な事業展開を図る

戦略方針（Vision）

成長分野である半導体アドバンスドパッケージ市場でのプレゼンス拡大と注力分野の選択と集中による高収益化

注力分野への集中投資	● 成長拡大の見込める半導体分野*にリソースと投資を集中 *市場成長が見込める半導体アドバンスドパッケージ領域及びサーマルプロセスなど
製品ラインアップの強化	● 半導体アドバンスドパッケージ分野の進化においてプレゼンス拡大のためAMAT社との業務提携による強固な製品ラインアップへ ● サーマルプロセス分野ではLED光源を新たに導入し、３つの光源による半導体領域でのサーマルソリューションを展開 ● 露光用ランプで新規分野へのビジネス拡大に向けた製品ラインアップ強化
収益性向上	● 外部環境変化にも対応できる戦略的な製品構成比率の改善 ● 露光装置中心に販売からアフターサービスまでのトータルビジネス体制の構築 ● 今後の事業性が見込めない分野は見直しを検討
人財戦略	● 他事業からリスキルを進めIP事業の人財を拡充

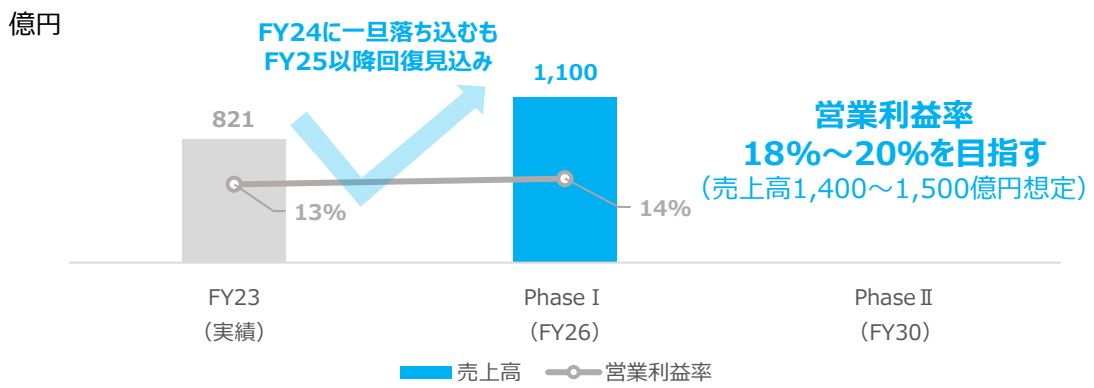
事業環境

半導体市場
需要回復の兆しが見えつつあり、AI進展に伴うニーズを中心に中長期での市場拡大を見込む

半導体アドバンスドパッケージ市場
足元はサーバー及びパソコンの市況悪化に伴い、関連する設備投資の抑制が発生。一方で、生成AIの本格普及によるAI関連投資が拡大しており、パッケージ基板の大型化やチップレット化が加速し、高度なパッケージ基板ニーズが高まる見込み

FPD市場
コロナ特需の反動は底を打ったものの市場ニーズは当面横ばい

係数目標



Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

半導体アドバンスドパッケージ市場でのプレゼンス拡大①

USHIO

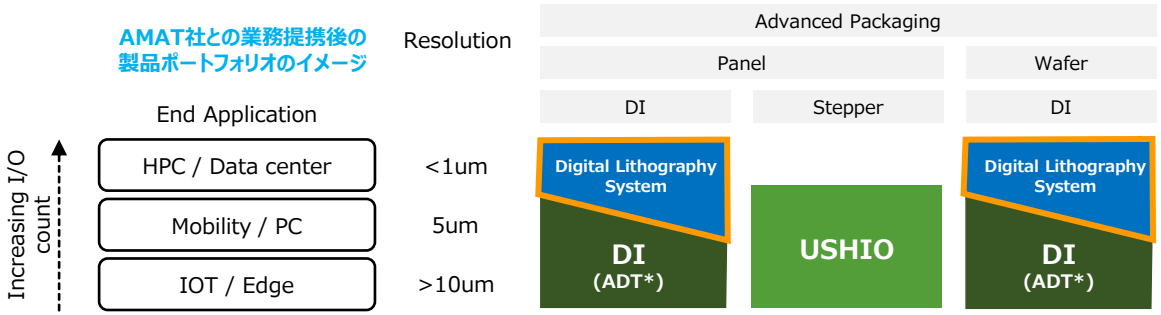
製品のフルラインアップ化と顧客カバレッジの拡大で、半導体アドバンスドパッケージ市場におけるリーディングカンパニーを目指す

戦略方針（Vision）

半導体アドバンスドパッケージ市場におけるリーディングカンパニーへ

① フルラインアップ化

- AMAT社との業務提携により新たにデジタルリソグラフィ装置が加わり、既存のステッパ露光装置とDI露光装置も含め、進化が進む半導体パッケージ基板において、幅広いアプリケーションや顧客ニーズに応えるフルラインアップ化が実現



②顧客層の広がりによる安定した売上基盤構築

- 新たにデジタルリソグラフィ装置が加わることで、従来の主要顧客層への依存が解消し、顧客層の拡大が見込めることから、安定した売上高基盤を構築

＊ ADT＝グループ会社であるアドテックエンジニアリングの略

事業環境

- 生成AIを活用した世界の進展に伴い、HPCやデータセンターがインフラ化。増加するデータ量に対応するために先端半導体の市場が成長
- 世界のデータ量及び電力消費増加に対応するために、半導体の更なる性能向上・省電力化が実現できる新たな半導体パッケージ基板構造の開発が進展。大型チップ化やチップレット化が進むとともに、半導体に係る素材の見直しも

事業戦略

フルラインアップ化

- AMAT社との業務提携を通じて2μm以下へのニーズに対応。半導体関連業界でのプレゼンスや競争力の向上を目指す
- ADT＊との協業推進により、既存のDI露光装置を含めたニーズの更なる取り込みと有機基板での成長を目指す
- 既存の露光装置と新製品(デジタルリソグラフィ装置)を組み合わせることで、顧客のあらゆる用途・ニーズをワンストップで対応できる販売及びアフタービジネス戦略が強化される

安定した売上基盤構築

- フルラインアップ化による従来の顧客層以外への販売を強化
- 戦略的に主要顧客層向け比率を引き下げることで、特定の顧客への依存リスクを回避

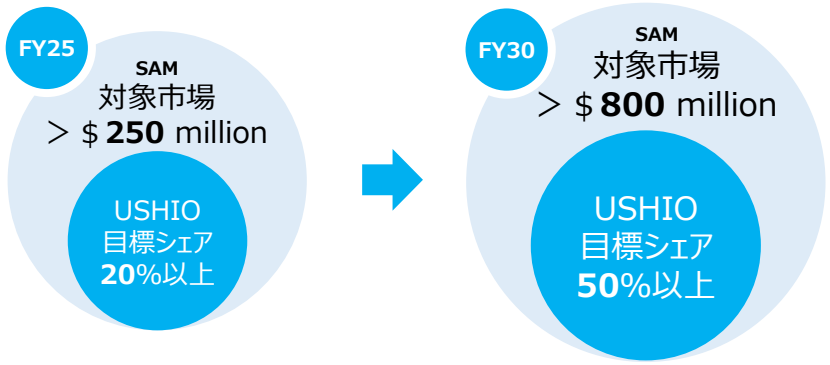
Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

事業拡大 半導体アドバンスドパッケージ市場でのプレゼンス拡大②

AMAT社との業務提携によるデジタルリソグラフィ装置をドライバーに、成長する半導体アドバンスドパッケージ市場において売上拡大を目指す

デジタルリソグラフィ装置で対応する半導体アドバンスドパッケージ市場



- **対象市場(SAM)が拡大　FY25:$250M→FY30：$800M**

  AI進展に伴い最先端ICパッケージ基板は大きく進化する見込み

  →チップレット化やパッケージ基板の大型化への対応ニーズが増加

  →更なる半導体性能向上、省電力化などに対応するためパッケージ基板がより高度化

  （→２μm以下～サブμmへの対応ニーズが増加）

- **デジタルリソグラフィ装置が今後の市場において採用されると考える理由（特徴）について**

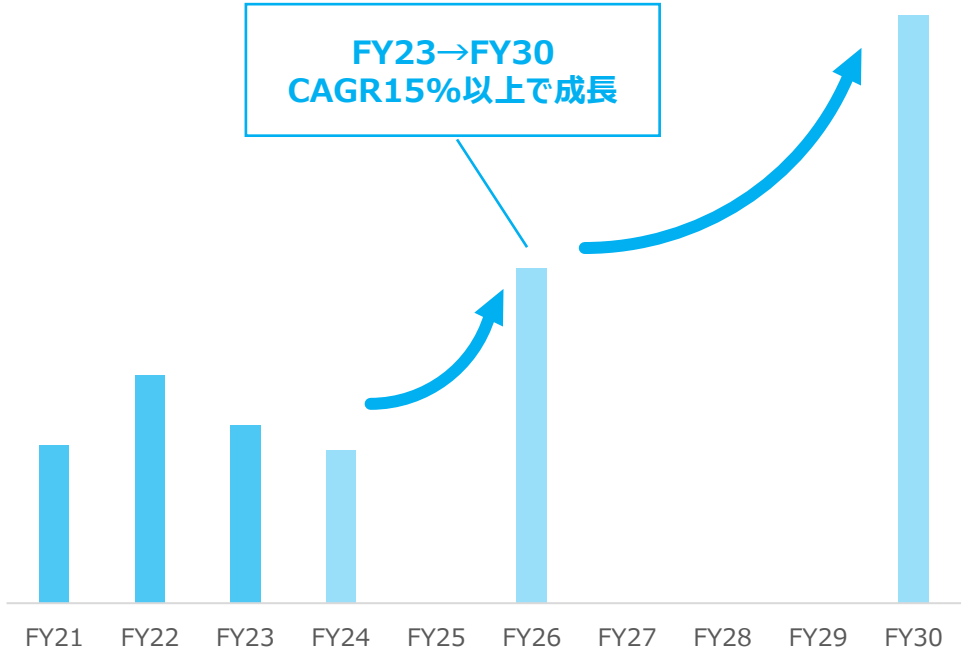
  従来のDI露光装置に対し、高度なデジタル処理技術（DLT）を搭載することで、以下の対応が可能

  →基板の大型化＝＞従来のタクトを維持し生産性を損なわない処理が可能

  →パッケージ基板の高度化（微細化）＝＞チップレット化による歪みやダイの配置誤差に的確に対応

  ＝＞結果、インターポーザー基板の変化（パネル化、Bridge(シリコン＋樹脂)化、RDL化）に適応

半導体アドバンスドパッケージ向け露光装置*全体の売上推移



*ステッパ露光装置、DI露光装置、デジタルリソグラフィ装置を含む

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

開発投資方針

2030年の目指したい姿に向け、PhaseⅡで利益貢献を視野に投資を実施
ただし、投資期間や利益貢献のモニタリングを強化し、毎年、投資分野のアロケーションを見直す
特に、IP事業_EUV・VI事業・PHS事業は、今後の事業の方向性により投資戦略を見直す可能性あり

単位：億円	累積開発投資（FY24-26）	開発投資 内訳			詳細説明 アイコンはP19-22の注力分野と対応
IP Industrial Process	280	露光装置	約150億円	●AMAT社と共同によるデジタルリソグラフィ装置の開発、上市 ●次世代露光装置の開発	IP1 ▶詳細P19
		EUV	約60億円	●High－NA領域への参入を目指し、更なる高輝度・高安定性及びコストダウン実現のための開発	IP3 ▶詳細P19
		その他	約70億円	●露光用ランプ：高照度化・長寿命化対応　及び　新分野向け新品種開発 ●半導体サーマルプロセス：新規LED加熱源の開発　他	IP2 ▶詳細P19
VI Visual Imaging	75	映像装置	約75億円	●高付加価値な提供に必要な新製品開発　他	VI1 ▶詳細P20
LS Life Science	85	－	約85億円	●有望分野への投資及び製品開発 ●有望事業創出に向けた取り組み	LS1 ▶詳細P21
PHS Photonics Solution	35	－	約35億円	●競争力強化に向けた製品ラインアップ拡充への開発	PHS1 ▶詳細P22
合計	**475**				

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

PBRの改善に向けた取り組み

新成長戦略の着実な実行及び株主還元の拡大による資本最適化により株主資本コスト*を上回るROE目標を掲げ、早期のPBR1倍超を実現

PBRの改善

ROE

▶ 詳細P28

×

PER

利益成長
営業利益率向上

資本最適化
自己資本2,000億円以下

＝

ポートフォリオ変革を踏まえた新成長戦略の実現

自社株投資＋配当による資本の圧縮

新成長戦略の各施策の着実な実行と計画の厳格なモニタリングにより実効性を高める

*株主資本コスト ： **7％程度**　加重平均資本コスト（WACC） **6％程度**と推定

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

ROE向上に向けての考え方と具体的な施策

新成長戦略を着実に推進するとともに、資本最適化を含めたバランスシートの改善(スライド29)を進めることで
ROE12%以上の達成を目指す

	FY2023(実績)	FY2026	ROE向上実現に向けた施策
ROE	**4.5 %**	**8 %以上**	**FY2030：12 %以上**
=			
売上高純利益率 当期純利益÷売上高	6.0 %	約 8 %	● ポートフォリオ変革を踏まえた新成長戦略の各施策を着実に実施することで売上高純利益率を向上
×			
総資産回転率 売上高÷総資産	0.53 回	約 0.6 回	● 半導体アドバンスドパッケージ事業の拡大による運転資本の増加を計画も、露光装置中心とした生産リードタイム改善などにより資産圧縮を進める ● 有価証券の売却加速により金融資産を事業資産/株主還元へ振替
×			
財務レバレッジ 総資産÷自己資本	1.42 倍	約 1.7 倍	● Phase Ⅰ：資本最適化*のため自社株投資拡大や下限配当設定による株主還元を拡大 （*自己資本は2,000億円以下を維持） ● Phase Ⅱ：機動的な自社株投資を計画 ● 財務レバレッジ向上のため有利子負債を活用

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

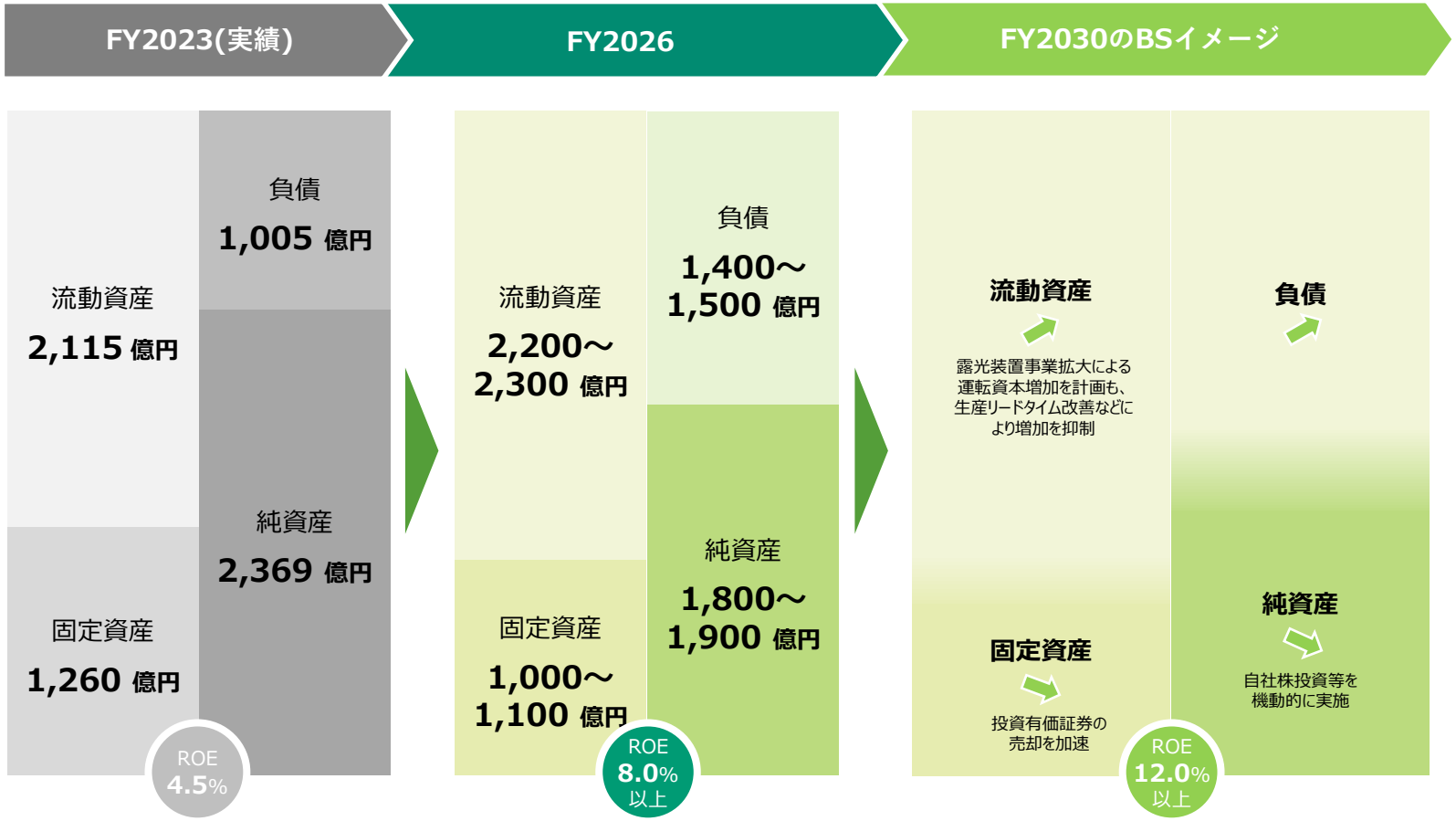
BSマネジメント方針

USHIO

成長投資拡大も財務規律を重視した経営を推進かつ資産効率を改善

BSマネジメント方針

- 株主還元の拡大を通じ資本コントロールを行い、自己資本は2,000億円以下とし、維持する
- 有価証券の売却加速により金融資産から事業資産/株主還元へ振替
- 成長投資及び事業拡大によりPhase Ⅱ での運転資本の拡大を計画も、各資産回転率のモニタリングを強化
- 財務レバレッジ向上のため有利子負債を活用



※表内各項目の矢印は、対FY2026からの増減イメージ

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

キャッシュアロケーションと成長投資

PhaseⅠでは有価証券売却及び有利子負債の活用により、成長投資と株主還元強化を両立させ、早期のPBR１倍超を目指しROE８％以上を達成させる
（PhaseⅡでは、営業CFをベースに成長投資拡大しつつ、株主還元とのバランスを取りながら**ROE12%以上**を目指す）

Phase Ⅰ [FY24-26]　→　**Phase Ⅱ [FY27-30]**

ROE 8%以上の達成 / PBR 1倍超の実現

[Cash-in]

- 有利子負債等 **250億円以上**
- 有価証券売却 **350億円**
- 営業CF **500億円**

[Cash-out]

- 成長投資 **400億円以上**
- 自社株投資 ＋ 配当 **650～750億円**

参考：FCF 約500億円

PhaseⅠにおける成長投資の計画

成長投資（M&A含む）
400億円以上（3ヵ年累計）

- ●半導体アドバンスドパッケージ向け露光装置関連：約70億円
- ●EUVマスク検査用EUV光源関連：約30億円
- ●老朽化設備更新　他

M&A方針
- ●IP：半導体アドバンスドパッケージ領域に注力
- ●VI：高付加価値事業の成長拡大に必要なパートナーシップ
- ●LS：有望製品及び創出事業の強化・拡大
- ●PHS：補完性ある同業他社への投資による事業強化・拡大

目標ROE 12 %へ

[Cash-outイメージ]

- **成長投資** 拡大
- **自社株投資 ＋ 配当** **機動的かつ安定的に実施**

参考：FCF 約800億円

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

有価証券売却スケジュール　及び　政策保有株式縮減方針

USHIO

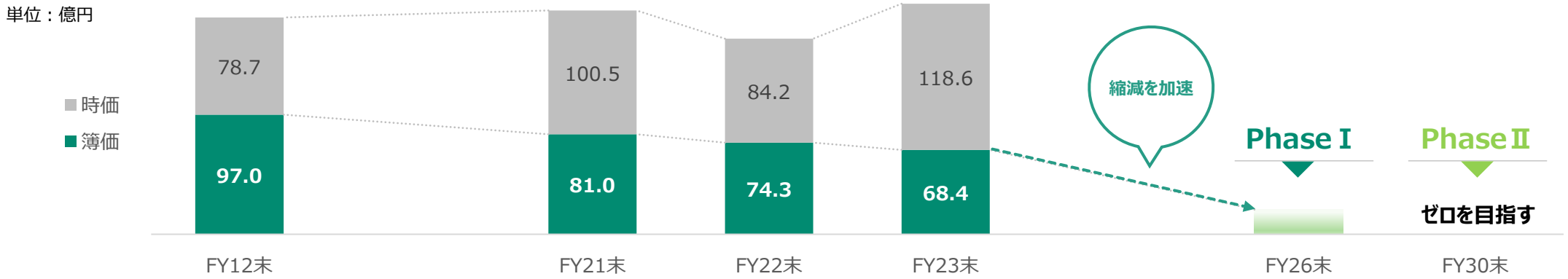
有価証券*売却予定スケジュール（キャッシュフローベース）

FY23 実績	Phase Ⅰ（FY24～FY26）	Phase Ⅱ（FY27～FY30）
▲131億円	約▲350 億円	▲150 億円以上

*政策保有株式、長期債券及び純投資株式

政策保有株式縮減方針

方針に則り、政策保有株式の縮減を加速させる



	FY12末	FY21末	FY22末	FY23末
銘柄数	26	13	12	11

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

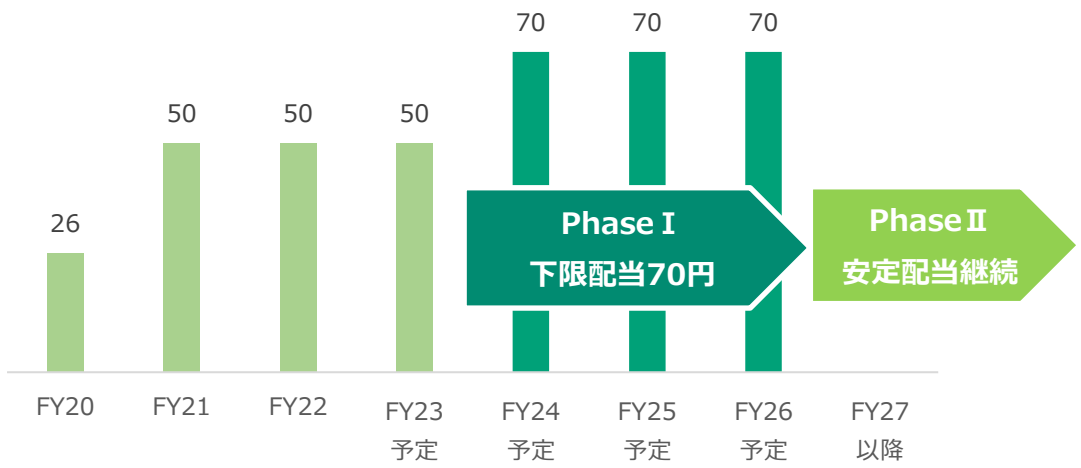
株主還元方針

PhaseⅠ：下限配当１株当たり70円を設定し、自社株投資は500～600億円を実施する計画
（PhaseⅡ：機動的な自社株投資等を実施し、自己資本は2,000億円以下を維持）

配当方針

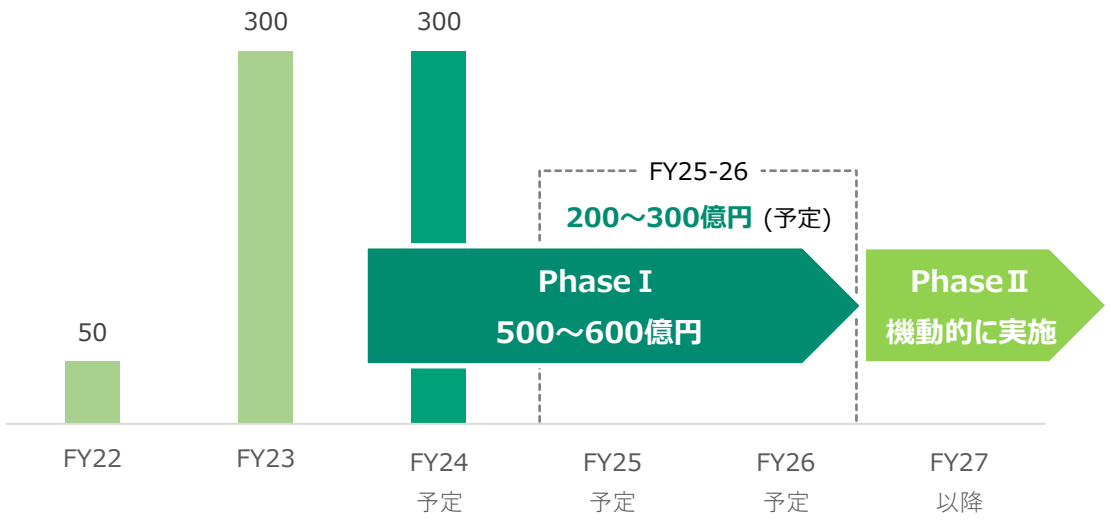
単位：円

１株当たりの配当額推移見込み



自社株投資

単位：億円



Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

第4章

ESGへの取り組み

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

サステナビリティの一層の強化へ　～事業とサステナビリティの両輪経営

Revive Vision 2030達成に向け、ESG経営への取り組みは継続。寄り添い、共有・共感できる、ESGの実感価値提供を目指す

Phase Ⅰ …… Revive Vision 2030 …… Phase Ⅱ

第1次中期経営計画　第2次中期経営計画（前中期経営計画）

FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026	FY2027	FY2028	FY2029
マテリアリティの特定・実践準備			本格運営（KPI明確化）→浸透→自走展開、安定運営へ						

Revive Vision 2030

＜FY2021＞

「5つの経営のフォーカス」を策定

長期的に社会の課題解決に取り組みながら、企業としての価値を日々向上させていくための重要課題

1. より社会的価値の大きい事業創出
2. ビジョンに近付くための人財の質向上
3. 成果を上げやすい職場環境作り
4. 持続的な環境負荷低減
5. 強固な経営基盤の構築

＜FY2022～＞

ESG推進本部を設立（2022年4月）

- 「5つの経営のフォーカス」推進
- 内部・外部エンゲージメントの向上
  - ・内部：従業員エンゲージメントの実施と分析
  - ・外部：外部評価の分析と開示対応
- KPI設定のための仮説検証、目標設定

※FY2024よりサステナビリティ推進部門へ改称

FY2023以降

事業成長とESGの両軸で、Revive Vision 2030達成を目指すべく、非財務KPI目標を明確化し、活動を本格推進

「光」のイノベーションカンパニー

インダストリアルプロセス領域を主体にお客様とともに成長する

＜業績目標＞

ROE
12%以上

（参考値）
営業利益率
12%以上

売上高
2,000～2,500億円

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

エンゲージメント向上に向けた施策

2023年度目標は概ね達成。2024年度以降も着実な活動により、エンゲージメントの更なる向上を目指し、業績への寄与を期待

	FY2023活動実績	FY2024活動計画	業績への貢献期待
内部エンゲージメント	**エンゲージメントスコア** FY2023目標：**56%**　FY2023実績：**56%**（前年度比＋4pt） **①対話会** ● 経営理念、中期計画の理解促進 **②施策実施** ● マテリアリティ理解促進 ● 自業務との紐づけ理解	**①発信** ●ESGの理解度促進に向けた発信強化 ●自業務とマテリアリティとの連動意識付け **②施策展開** ●ESGを理解・体感できる施策展開 **③エンゲージメントサーベイの継続実施** ●定点観測 **④エンゲージメントスコア分析および提言** ●施策の効果検証、優位点、課題の共有	**社員エンゲージメントスコア向上による営業利益率向上の相関効果**
外部エンゲージメント	**エンゲージメントスコア** FTSE⇒ FY2023目標：**3.5**　FY2023実績：**4.0**（前年度比＋0.8） S&P　⇒FY2023目標：**40**　FY2023実績：**43**（前年度比＋6） CDP　⇒FY2023目標：**B-**　FY2023実績：**B-**（前年度：C） **①スコア改善への分析** FTSEメソドロジー解析 **②サステナビリティサイトのリニューアル** ● ユーザビリティ向上 ● 非財務開示土台の完成 **③GHG第三者検証** ● 情報の信頼性担保 ● 義務化対応	**①主要外部評価分析力向上** ●メソドロジー解析の対象拡大 **②非財務情報開示義務化への対応**	**①外部評価とPBRの相関効果** （ESG推進本部独自調べ） **②ESG投資INDEX選定** （投資呼込） **③法規制対応による業績へのマイナスインパクトの回避**

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

人財戦略～新成長戦略に基づく人財投資の基本方針

Revive Vision 2030

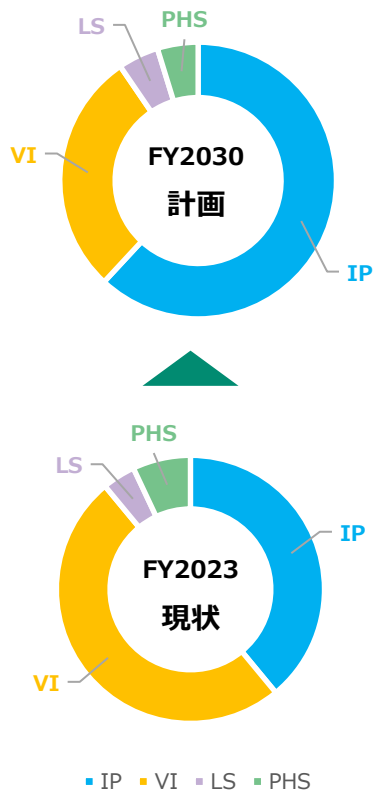
1
半導体関連事業において
競争力のある人財戦略を検討し、
必要人財を確保できる態勢整備

2
他事業からの配置転換を推進。
評価適正化を通じて
人員数・総人件費をコントロール

3
管理指標を人員数管理から
総人件費管理に変更。
メリハリのある仕組みに変革

セグメント別人員構成イメージ

事業方針に合わせ
ウシオグループ全体の人員数を
コントロール



成長事業への人財集中投資とリスキリング

人的投資増強

- 半導体アドバンスドパッケージ領域で、特に重要な**技術営業、カスタマーサポート、製造技術、製造ライン、品質保証の人員を増強**
- 主に**カスタマーサポート、製造技術、製造ライン、品質保証は他事業からリスキルした人財**を投入
- 台湾・韓国を中心に海外の**主要顧客をカバーするための人員増強**
- 事業のキーとなる人財の外部採用

構造改革

- **グループ全体の総人件費をコントロール**
- **事業の方向性に合わせた製造スリム化と拠点の統廃合**

採用と育成

- 事業戦略に沿った人財配置・育成を徹底。**装置技術・製造へのリスキル支援を中核施策に**
- **インダストリアルプロセス事業（特に半導体製造技術）関連を中心にした採用戦略**
  高度人財採用も露光事業に特化して推進

報酬体系

- 半導体製造装置業界をベンチマークとし報酬水準の妥当化
- 単純な総人件費増を防ぐ適正な評価

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

Appendix

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

前中期経営計画の振り返り　補足

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

「半導体製造装置の市場動向とPCパッケージ基板の急減速」について

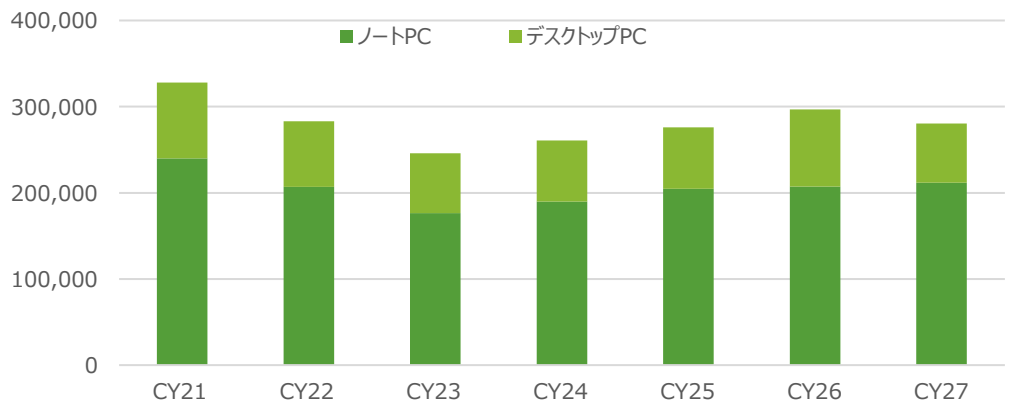
PC市場の需要減速による生産調整により、パッケージ基板市場は停滞、キャパシティ過多の状況が続く見通し

その結果、後工程関連装置メーカー各社は2022年度Q3より対前年度比でマイナス成長に

PC市場推移

- 2021年、コロナ禍でのリモートワークの増加による特需により、3.5億台/年を記録したが、コロナのリスクが低下した2022年より需要は減速、2023年にかけて生産が大きく下落
- 2023年はコロナ禍の特需が終了し、需給調整が継続も、2024年上期には需給バランスを取り戻す見込み

世界のパーソナルコンピュータ市場の実績及び見通し（千台）

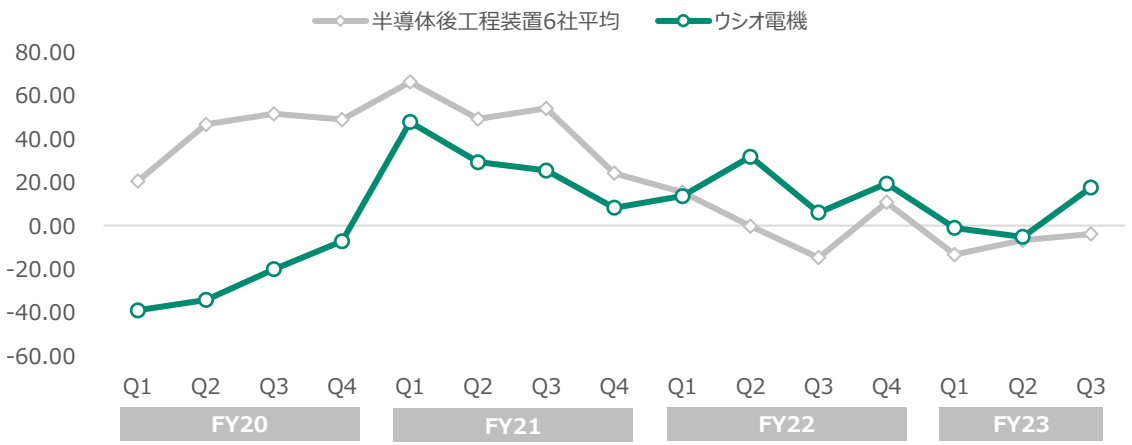


出所）MIC「Global Server Forecast」、IDCより作成

半導体製造装置の市場動向

- 2022年まではメーカー各社が市場拡大と共に設備投資を拡大してしまったため、需要減少の2023年以降、キャパシティ過多の状況が継続（2025年頃までを見込む）
- 結果、2022年度Q3以降、後工程関連装置メーカーのマイナス成長が継続状況

半導体後工程装置6社平均との業績比較：売上前年同期比（%）



出所）各社IR資料より作成

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

「成長事業における主要顧客層への依存」について

PC需要の減速に加え、サーバー市場において需要拡大も各社のシェアに大きな変動が発生

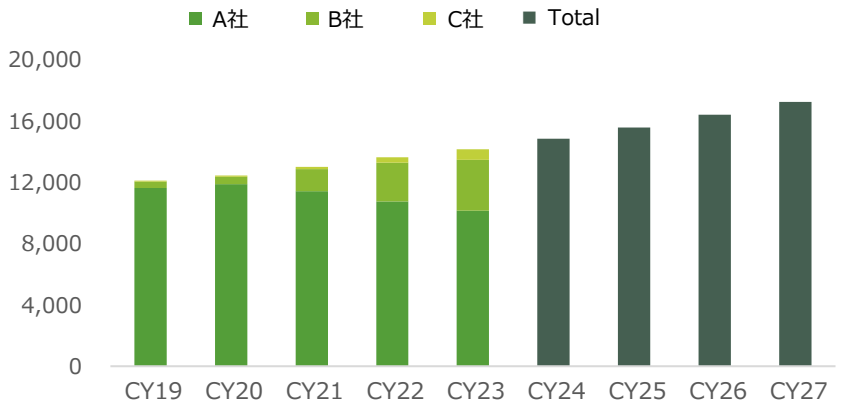
主力のステッパ露光装置を中心に、主要顧客層の依存度が高く、売上高及び利益の未達の主要因に

PC需要の減速に伴うパッケージ基板市場の停滞

▶ 詳細P39

サーバー市場は需要拡大も各社シェアが大きく変動

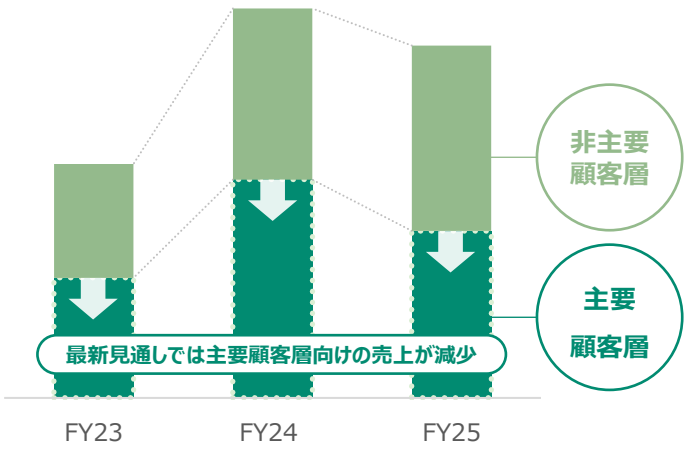
半導体サプライヤ別世界のサーバー出荷実績及び見通し（千台）



出所）MIC「Global Server Forecast」、IDCより作成

その結果、現状ステッパ露光装置は
主要顧客層への依存度が高く
見通しに大きな影響が生じている

前中計のステッパ露光装置の
顧客層別売上高イメージ



新成長戦略では

依存度の問題は
解消の方向へ

▶ 詳細P24

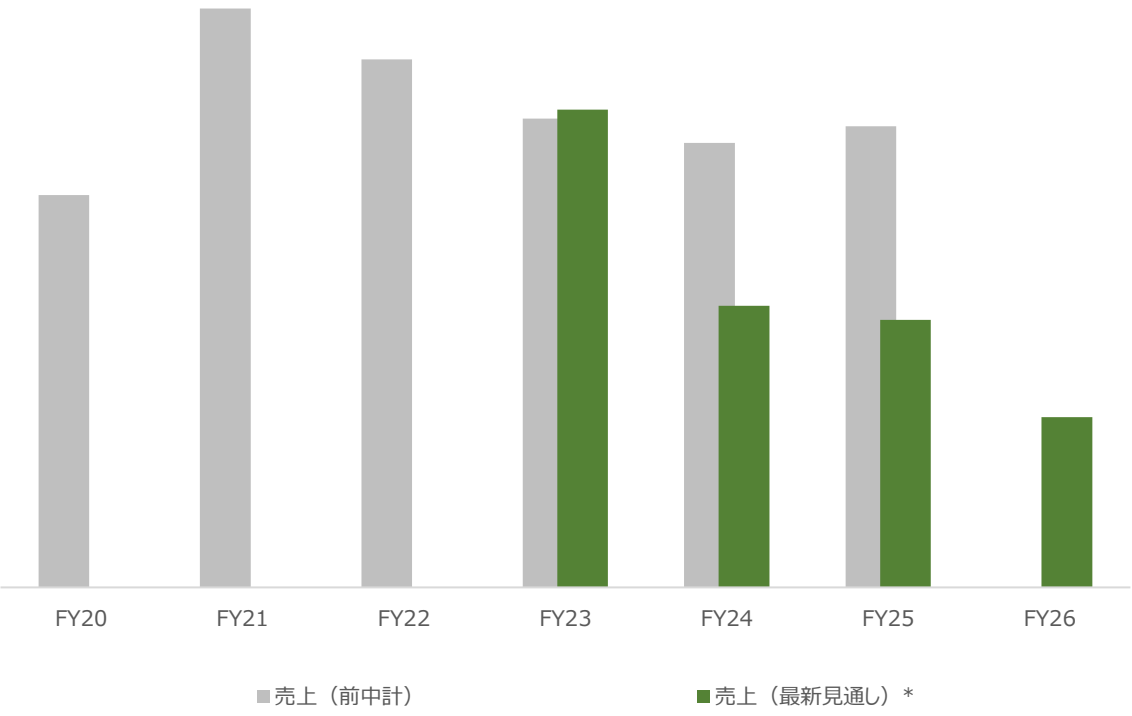
Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

「EUV競争環境変化」について

USHIO

EUVマスク検査用光源において、他社光源の台頭により見通しの修正が必要となった

売上高の最新見通し（対前中計）



*FY23の数値は実績値

見通しの修正要因

市場要因	● コロナ特需の反動等を背景としたPC販売不振等に起因する半導体市場の下落によって顧客の投資額減少
顧客要因	● 他社光源の台頭により、当面新規案件獲得が難しい見込み ● 半導体サプライヤーからの厳しいランニングコスト低減要求あり
競合要因	● EUVマスク検査用途の光源はウシオが先行していたものの、他社光源が台頭
自社要因	● 主にコスト面での課題に対処しきれず

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

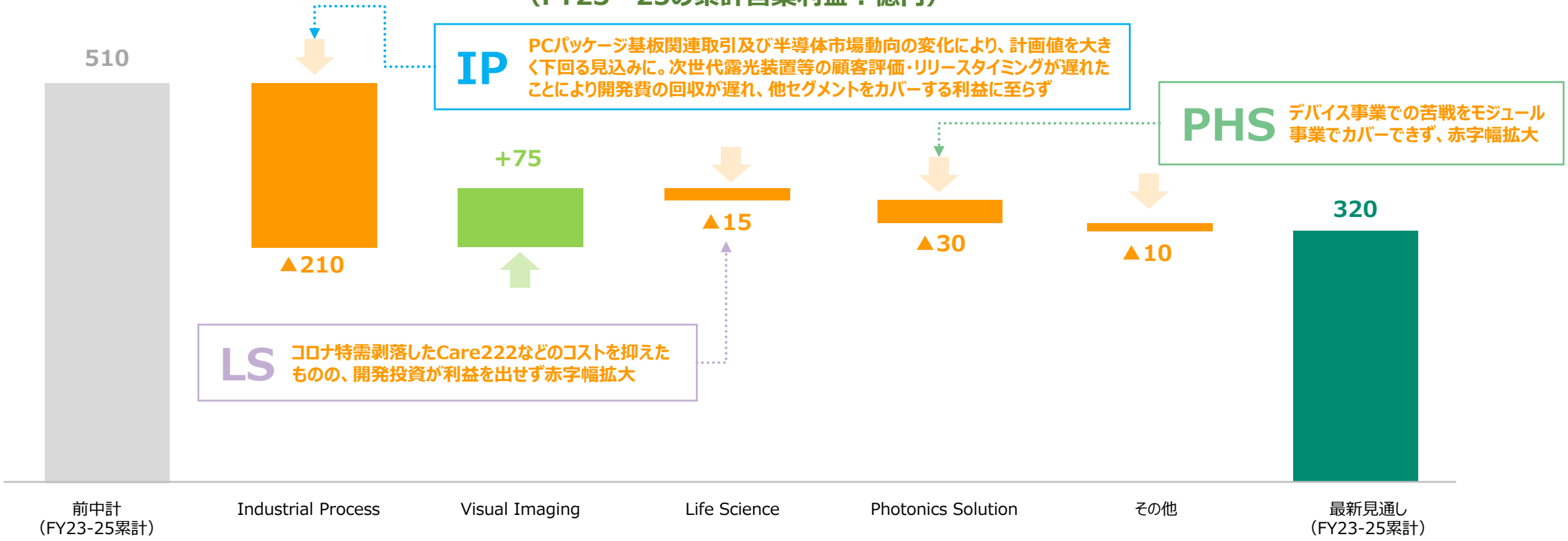
USHIO

「不採算事業の影響」について

開発投資の利益貢献タイミングが後ずれとなり、前中計期間の収益に影響

IP事業も計画値を大きく下回る見込みとなったことにより、赤字事業をカバーするシナリオが崩れる結果に

前中計と最新見通しの営業利益の乖離
（FY23～25の累計営業利益：億円）



Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

事業戦略　補足

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

Industrial Process事業の戦略方針 再掲

USHIO

半導体アドバンスドパッケージ事業を柱としてIP事業を成長・強化。リソースを集中し、迅速な事業展開を図る

戦略方針（Vision）

成長分野である半導体アドバンスドパッケージ市場でのプレゼンス拡大と注力分野の選択と集中による高収益化

注力分野への集中投資	● 成長拡大の見込める半導体分野*にリソースと投資を集中 *市場成長が見込める半導体アドバンスドパッケージ領域及びサーマルプロセスなど
製品ラインアップの強化	● 半導体アドバンスドパッケージ分野の進化においてプレゼンス拡大のためAMAT社との業務提携による強固な製品ラインアップへ ● サーマルプロセス分野ではLED光源を新たに導入し、３つの光源による半導体領域でのサーマルソリューションを展開 ● 露光用ランプで新規分野へのビジネス拡大に向けた製品ラインアップ強化
収益性向上	● 外部環境変化にも対応できる戦略的な製品構成比率の改善 ● 露光装置中心に販売からアフターサービスまでのトータルビジネス体制の構築 ● 今後の事業性が見込めない分野は見直しを検討
人財戦略	● 他事業からリスキルを進めIP事業の人財を拡充

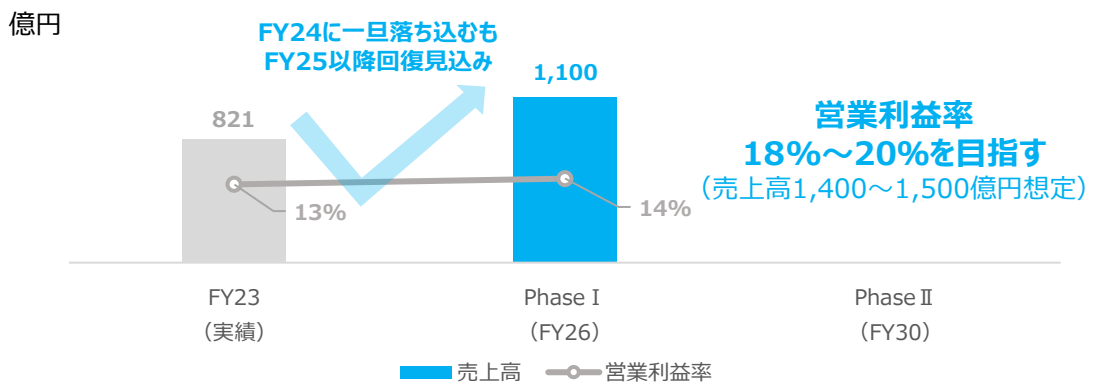
事業環境

半導体市場
需要回復の兆しが見えつつあり、AI進展に伴うニーズを中心に中長期での市場拡大を見込む

半導体アドバンスドパッケージ市場
足元はサーバー及びパソコンの市況悪化に伴い、関連する設備投資の抑制が発生。一方で、生成AIの本格普及によるAI関連投資が拡大しており、パッケージ基板の大型化やチップレット化が加速し、高度なパッケージ基板ニーズが高まる見込み

FPD市場
コロナ特需の反動は底を打ったものの市場ニーズは当面横ばい

係数目標



Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

成長分野に注力

成長事業へのリソースシフト（サーマルソリューション分野）

光プロセス等その他IP ①サーマルソリューション分野

USHIO

成長市場である半導体サーマルプロセスに注力し、半導体産業の発展に貢献する

戦略方針（Vision）

フラッシュランプ（FLP）、ハロゲンランプ（HL）に新たにLEDを加えた３本の柱で
「光サーマルソリューションによる半導体産業の発展に貢献する」

● 半導体製造装置メーカーから信頼されるパートナー企業へ

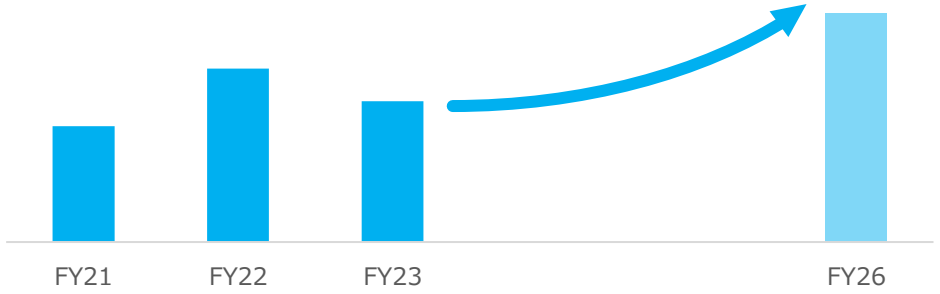
事業環境

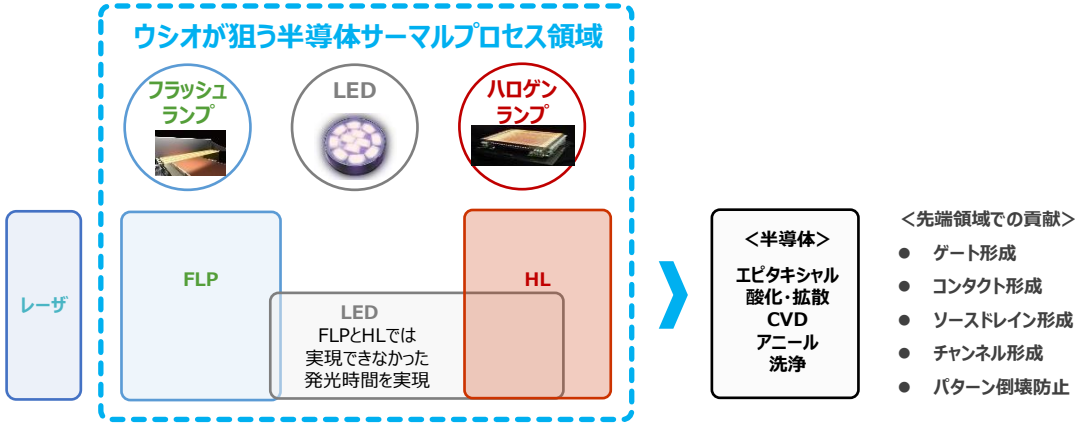
- 半導体の微細化技術の進展に伴い薄膜化と３次元構造化が進み、温度と膜厚制御性の高い熱処理技術のニーズが高まっている
- 先端ロジック及びDRAMでEpi成膜の工程が増え、エピタキシャル成長装置の需要が増える
- 半導体市場の拡大に伴い、半導体前工程製造装置市場、シリコンウエハ市場も大きく飛躍が期待される
- 放射加熱が使用される加熱プロセス工程の増加

事業戦略

- 主要顧客からの組み込み採用率向上（HL）
- パートナー企業との関係強化（FLP）
- LED光源を新規導入し新たな領域への参入（LED）
- ３つの異なる光（光源）により、より制御性の高い熱処理技術が提供可能へ

サーマルソリューション分野の売上高推移見込み





Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

成長分野に注力

成長事業へのリソースシフト（エキシマ分野）

光プロセス等その他IP ②エキシマ分野

USHIO

FPD市場依存から脱却し、半導体やプリント基板(PCB)・パッケージング(PKG)分野への開発投資を実施するなど注力領域を転換し安定した事業運営を継続

戦略方針（Vision）

FPD依存からの脱却 新注力領域への集中

- **市況が悪化しているFPD市場への追加投資抑制**
- **半導体/PCB・PKG分野顧客向けの商品ロードマップに沿った研究開発の実施**

事業環境

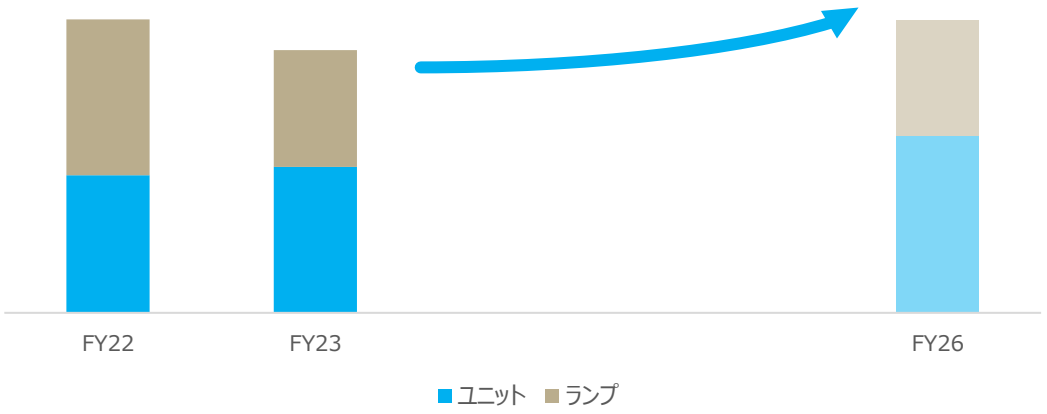
- FPD市場はコロナ特需後の反動で在庫過多となり、工場の新設や設備投資導入が延期
- 半導体等の市場は成長の見込み

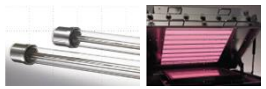
事業戦略

- FPD市場において95%*の高い世界シェアを維持も、市場成長は鈍化傾向のため、半導体やPCB・PKGなどへリソースをシフト
- 新たな市場として建材や車両/電池市場などをターゲットに事業拡大

*パネル洗浄用エキシマ光照射装置のシェア（自社調べ、2023年3月31日時点）

エキシマ分野の売上高推移見込み



エキシマ関連市場	FPD市場（OLED向け含む）	半導体市場（PCB・PKG分野含む）	その他、注力市場（建材、車輌/電池市場）
主な用途 	● パネル洗浄 等	● ウエハー等の膜除去 ● メッキ/SR塗布前の表面処理	● 建材のマット化 ● 電池の性能向上

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

事業性見極め

High-NA領域での参入に向けた取り組み継続と事業性の見極め

EUV

USHIO

他社光源の台頭による事業戦略の見直し 及び 新規顧客への取り組み強化によりHigh-NA領域での参入を目指す

ただし、今後の市場・開発動向次第で、事業推進の方向性を見極める可能性もある

戦略方針（Vision）

今後のHigh-NA領域での参入を目指す

- **High-NA領域で求められる性能（高輝度・安定性）及びコストに合致した製品開発を継続**
- **今後、事業や技術動向の環境変化が生じた場合は、事業の縮小・撤退も視野に入れ推進する**

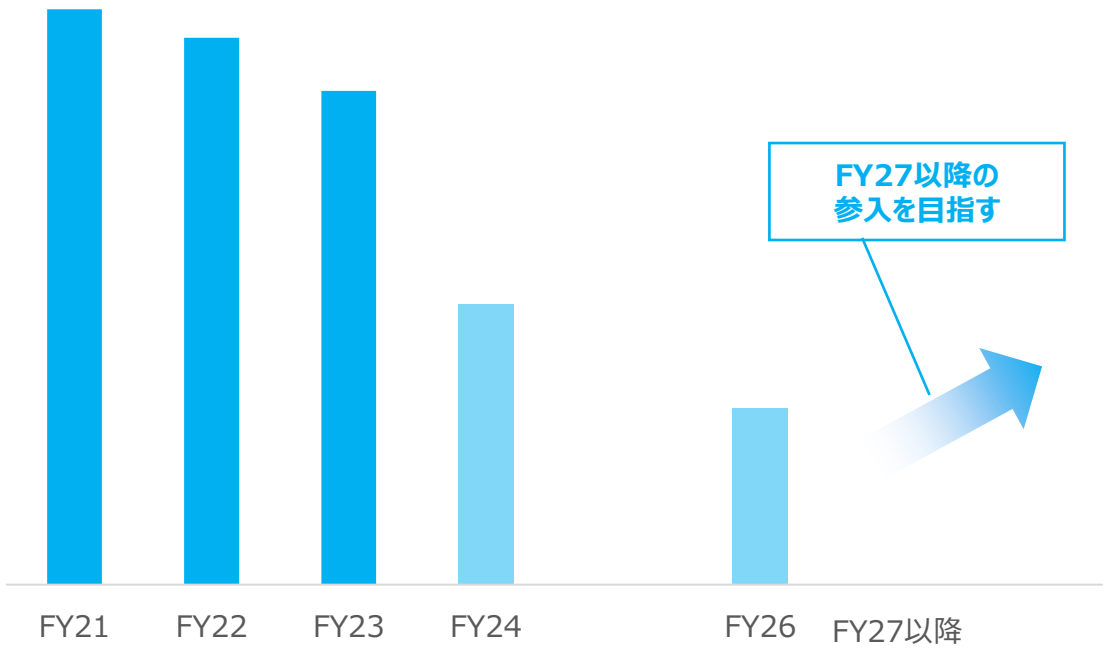
事業環境

- 他社光源の台頭で、しばらくは新規案件獲得が難しい状況
- APMI*市場ではHigh-NA化が進み、更なる高輝度・高安定性が求められる市場へ

事業戦略

- 稼働の減少による収益減少に対しTCO低減取り組みを行い収益性低下を最小限に抑える
- 新規顧客との開発を加速し、更なるHigh-NA化をターゲットとした開発及び事業化を推進（2027年度以降の新規採用に向け、現在評価実施中）
- 今後、計画と異なる事業及び開発の環境変化が生じた場合は、事業の縮小・撤退の見極めも視野に入れ推進する

EUV事業の売上高推移見込み



*APMI：Actinic Patterned Mask Defect Inspection （EUV光を使ったマスク欠陥検査装置）

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

事業安定化

安定収益の確保と強固な収益基盤の構築

露光用ランプ

USHIO

半導体領域における更なるシェア拡大及び半導体検査装置メーカーとの関係強化による新規分野へのビジネス拡大により、圧倒的なポジションを維持し、永続的かつ基盤となる収益を獲得し続ける

戦略方針（Vision）

収益基盤として貢献し続ける

- **半導体領域における更なるシェア拡大**
- **半導体検査装置メーカーとの関係強化によるビジネス拡大**

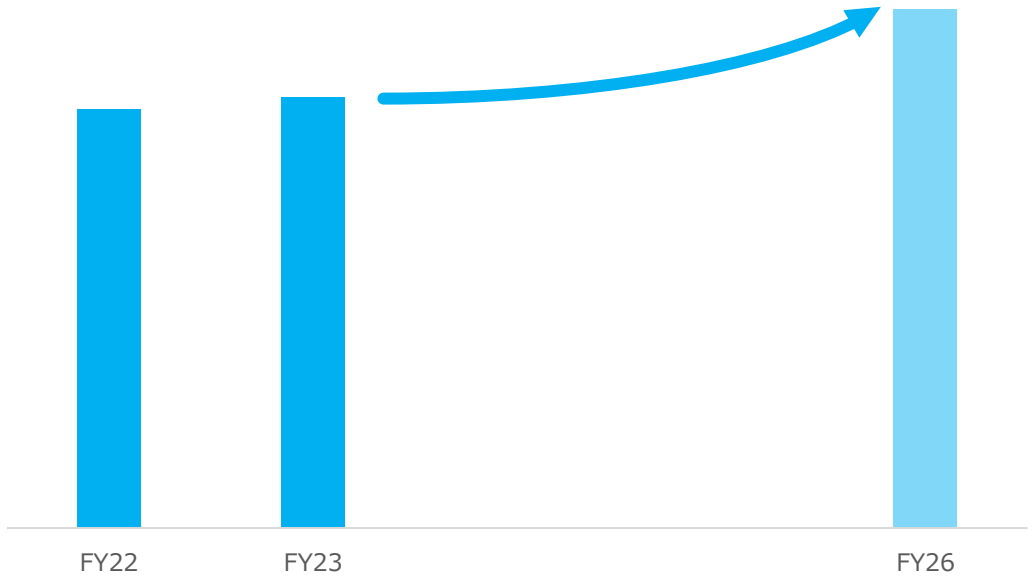
事業環境

- 半導体需要は回復傾向。ロジック、メモリの先端ICパッケージ基板需要の拡大でｉ線露光機の需要は増加
- FPD需要はコロナ特需後、新設投資は減少し稼働は横ばいの見込み
- 半導体の微細化により欠陥検査装置の需要が増加

事業戦略

- シェア奪取や事業提携等によりシェア80%以上獲得を目指す（現状シェアは70～75%）
- 半導体の微細化による検査用途ニーズを取り込み新たな分野へ拡大するための新品種投入
- 高照度化・長寿命化対応及び新分野向け新品種の開発
- 安定した収益率を確保し続けることで、グループ収益の基盤事業を継続

露光用ランプの売上高推移見込み



Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

VI事業の戦略方針

規模を追わず、収益力改善に向けた構造改革や事業の取捨選択を行う一方、
高収益・高成長領域へは集中投資を進めることで収益性改善を行う

戦略方針（Vision）

収益性改善・向上に向けた取り組み強化

コスト抑制とリソースの最適化	● 事業構造の見直しと取捨選択によりリソースを最適に配分し、販管費抑制を行うことで経営コストを最小化 ● 需要縮小が見込まれるプロジェクター用ランプについては、需要に見合ったリソース転換を先手打って対応
製品ラインアップ最適化	● 生産委託（OEM）やODMを活用し、固定費を抑制、削減しつつ、製品ラインアップの適正化を図る
リカーリングビジネス拡大	● 保守契約サービスによる安定した利益を維持、最大化 【リカーリングビジネスの売上高割合】 FY23：15% → FY26：20% を目指す
顧客取引拡大	● 付加価値の高い領域において、AVシステムコンサルティング事業の地域密着型深耕、テーマパーク向けビジネスの拡大
事業の取捨選択	● 各市場での成長性やポジション、シェアアップの可能性、収益構造などの総合的側面から事業や市場、製品展開を取捨選択する

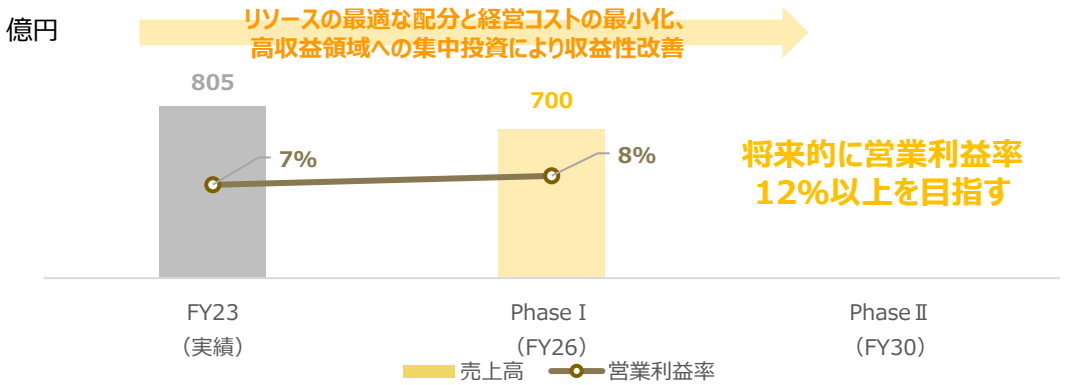
事業環境

シネマ市場
コロナ影響から回復し、デジタルシネマプロジェクターの置き換え需要が本格化。中長期で安定した需要を見込むも、足元は中国経済の悪化などによる新設抑制が発生

一般映像市場
中長期で全世界的なイベントやテーマパークなどへの設備投資が堅調に推移する見込みも、足元は中国経済悪化による投資意欲減退の影響あり

共通
プロジェクター光源のレーザー化が進み、プロジェクター用ランプの需要が徐々に縮小

係数目標



Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

施策の取り組み内容（VI）

USHIO

事業拡大 高付加価値事業であるAVシステムコンサルティング事業（注力事業）

事業環境

- パンデミック終息により、全世界で高度な映像演出によるイベント需要が再興、拡大傾向
- ハイエンドなプロジェクターやLEDパネルなどの映像機器需要が堅調

施策

- 主要な北米市場を中心に、地域に根差したローカルサポート体制強化により顧客満足度を向上させる
- 顧客の需要をまかなう幅広いラインアップ展開と、拠点増設、サービス力の強化によるリソース集中で売上増

収益性改善 製品に付随するリカーリングビジネスの割合増加（安定収益割合の増加）

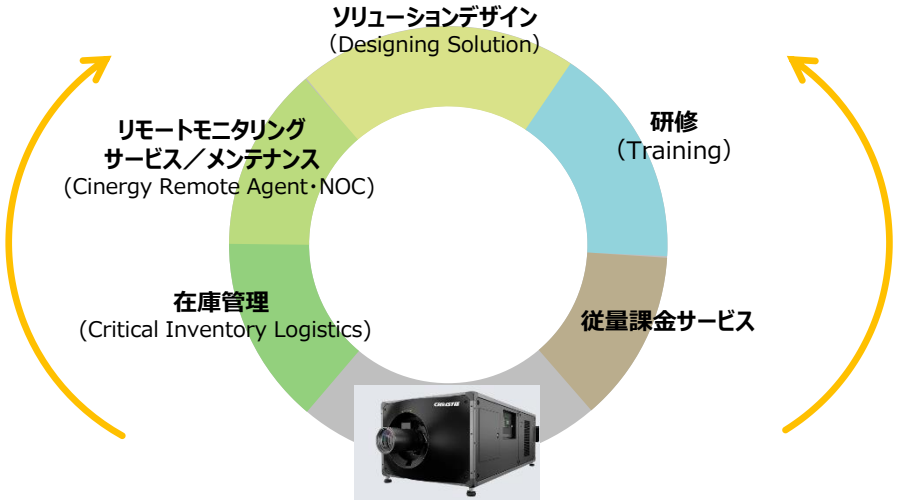
顧客ニーズ

- ワンストップサービスによる効果
  （操作性・利便性の向上、不具合への素早い対応定期メンテナンスなど）
- 修理や保守パーツ等ランニングコスト削減

施策

- モノ売りだけでなく、顧客ニーズに応えるサービスの提案力を強化し、付随サービスによる安定した収益確保を目指す

製品に付随するサービス（イメージ）



Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

LS事業の戦略方針

将来の新規事業創出に向けた取り組みは一定程度の継続はするものの、
各案件の事業成長の道筋がより見込める有望事業に絞り込み投資を行う

戦略方針（Vision）

需要の再検証を行い、見合った開発・経費へ絞り込む
費用支出を最小化しつつ、事業育成を図る

需要激減への対応	● 計画を下回り推移しているCare222は、経費、在庫ともに適正なものへ絞り込む
開発費・経費削減	● 事業化の道筋を再検証し、開発投資を絞り込む ● マイルストーン管理の徹底 ● 採算の見込めない分野を見極め早期に判断
事業育成	● 成長が見込まれる事業に絞り込み投資を実行

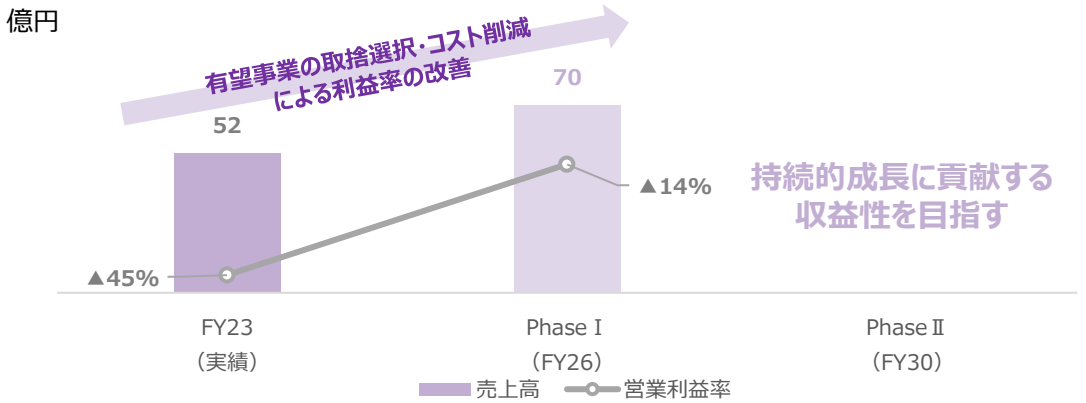
事業環境

Care222
アフターコロナで需要は低調。今後、規制・規格改正やエビデンス取得が進むことで、新たな顧客訴求力が強まる可能性あり

メディカル機器
国内市場は新規設置及び買い替え需要が堅調に推移。小型化・使い勝手向上により差別化を図る

ヘルスケア
緩やかな市場成長に対し、独自製品の開発によりリピータ増、新規顧客獲得を目指す

係数目標



Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

PHS事業の戦略方針

USHIO

競争力が低く、成長が望めない事業については見極めを行う。一方、ランプから固体光源への置換の対応含め成長領域へは積極的な投資 及び 継続的なM&A・提携を通じた事業成長を実現する

戦略方針（Vision）

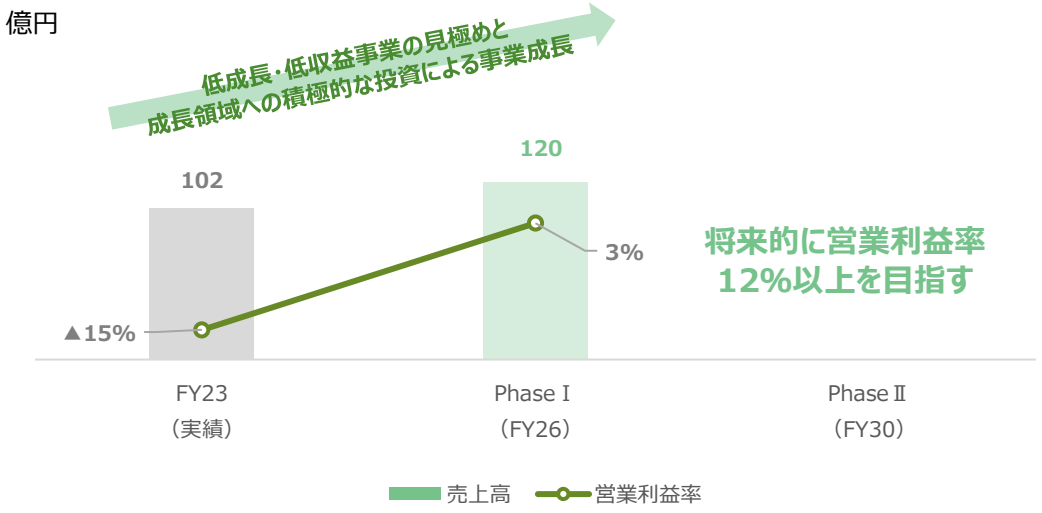
収益性の高いモジュール事業を中心とした事業体制を推進
M&A・パートナーシップを通じて事業成長を実現

事業の見極め	● 低成長・低収益事業の見極め
利益率の向上	● シナジーの創出と事業の合理化を推進 ● 成熟～衰退市場から成長市場へのリソースシフト ● 主要顧客との継続的な関係構築・強化を実施
成長領域への投資拡大	● 今後大きな成長が期待されるメガトレンドへの積極的投資を継続・拡大 ● 成長領域をリードするキープレーヤーとの協業を推進
M&A・提携	● M&A・パートナーシップを通じた事業成長を模索

事業環境

- 光源の固体光源化及びエネルギー効率向上の動きにより堅調に推移
- ライフサイエンス/AR・VR/ヘトロジニアスインテグレーション市場の拡大/立ち上がり

係数目標



Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

ESGへの取り組み　補足

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

5つの経営のフォーカス（マテリアリティ）と 2030年の目指す姿

経営のフォーカス	2030年の目指す姿	主要KPI（2025年）	経済価値とのつながり
より社会的価値の大きい事業創出	● 「気候変動対策」、「食糧問題」、「健康寿命の延伸」「ＤＸの実現」の４つの社会的課題に対する事業創出	● 新しい価値を持続的に生み出すR&D体制が確立し、一部のテーマで事業化の目途が立っている	新たな事業創出による 将来の売上・利益の拡大
ビジョンに近付くための人財の質向上	● バラエティに富んだ人財によるグループ経営実践と、計画的な育成 ● Global Mobilityによる社員のボーダーレスな活躍	● グローバル／技術／経営リテラシーを中心とした人財の拡充がなされている ● ビジネスニーズに即したタレントマップにより人財が可視化され、合理的なマネジメント体系が構築されている	新たな価値創造を可能にする人財の拡充により、利益が創出され、成長戦略が加速
成果を上げやすい職場環境作り	● 多様性を尊重する企業風土の構築 ● 社員が心身ともに健康で活き活きと働く状態実現 ● 会社と社員が共に成長する高い「エンゲージメント」	● 女性管理職比率：グループ全体15%以上、単体10% ● 従業員エンゲージメントスコア：62%（FY22比＋10P）	多様な人財に対する魅力ある働き場所・働き方提供による、エンゲージメント向上・生産性の向上
持続的な環境負荷低減	● 生物多様性取り組み・バリューチェーンにおけるGHG排出削減を通じた社会的課題の解決 ● 環境負荷低減をもたらす製品・サービスの提供	● 自社GHG排出量削減 (Scope1・2)：2017年度比▲34%以上 ● 自社販売製品GHG排出量削減 (Scope3 cat.11)：同▲30%以上 ● お客様の環境負荷低減に貢献する製品の効果が測定され、お客様に提案できている	環境配慮型製品による事業創出 社会的責任履行による企業価値維持・拡大
強固な経営基盤の構築	● 経営目標と各事業・社員各自の目標可視化・達成 ● 経営資源の適時把握による事業ポートフォリオ管理 ● 事業リスク明確化、リスク対応がグループ全体で展開 ● バリューチェーン全体での人権尊重風土・仕組み形成 ● ガバナンスの強化・深化	● 社会からの要請に対して、グループ全体で対応されはじめ、適切な開示により、外部評価機関やステークホルダーから一定の評価を受けている	安定した収益基盤の構築 企業価値毀損の未然防止

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

USHIO

ガバナンス体制の深化

Revive Vision 2030の実現、ESG経営推進の加速のため、コーポレートガバナンスの一層の強化を推進

2006年 ・・・ 2011年 ・・・ 2016年 ・・・ 2021年 ・・・ 2023年 ・・・ 今後の更なる取り組み → Revive Vision 2030

社外取締役		●社外取締役の選任（2012） ●社外取締役過半数(2016)			
女性取締役		●1名(2016)　●3名(2020)　●4名(2022)			
任意の諮問委員会		●報酬諮問委員会の設置(2015) ●指名・報酬諮問委員会の設置(2019)		**●サクセッションプランの実行（指名・報酬諮問委員会） －社長交代**	●既存の仕組み・体制の活用と改善
報酬制度	●役員退職慰労金廃止(2005)	●株式報酬導入(2015)	●役員報酬制度改定(2020)	**●役員報酬制度改定 －ESG指標導入 ●株式報酬制度改定 －中計達成目標のKPI化 株式報酬比率のアップ**	●取締役会の情報開示の充実 ●グループガバナンスの更なる強化 ●内部統制システムの強化 ●リスクマネジメントの強化
制度・方針	●執行役員 委任型へ移行(2008)	●取締役・執行役員 任期1年間に短縮(2015)			
その他		●監査等委員会設置(2016)		**●社外取締役が取締役会議長に就任**	

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

索引

USHIO

新成長戦略の全体像

中期経営計画の見直しの背景 4
2030年の目指す姿 5
Revive Vision 2030で目指すもの（係数目標 / 方針） 6
Revive Vision 2030で目指すもの（事業戦略 / 財務戦略） 7

前中期経営計画の振り返り

見通しの修正① 9
見通しの修正② 10
見通し修正に至った要因 11
重要課題を踏まえた新成長戦略「骨子」 12

新成長戦略「Revive Vision 2030」の具体的な施策

Revive Vision 2030 の位置づけ 14
新成長戦略（Phase Ⅰ）の基本方針と概要 15
参考値（セグメント別） 16
ポートフォリオ変革の方向性 17
事業ポートフォリオの変革（セグメント全体） 18
セグメント別ポートフォリオと施策（IP） 19
セグメント別ポートフォリオと施策（VI） 20
セグメント別ポートフォリオと施策（LS） 21
セグメント別ポートフォリオと施策（PHS） 22
Industrial Process事業の戦略方針 23
半導体アドバンスドパッケージ市場でのプレゼンス拡大① 24
半導体アドバンスドパッケージ市場でのプレゼンス拡大② 25
開発投資方針 26
PBRの改善に向けた取り組み 27
ROE向上に向けての考え方と具体的な施策 28
BSマネジメント方針 29
キャッシュアロケーションと成長投資 30
有価証券売却スケジュール　及び　政策保有株式縮減方針 31
株主還元方針 32

ESGへの取り組み

サステナビリティの一層の強化へ　～事業とサステナビリティの両輪経営 34
エンゲージメント向上に向けた施策 35
人財戦略～新成長戦略に基づく人財投資の基本方針 36

Appendix

前中期経営計画の振り返り　補足
外部要因：「半導体製造装置の市場動向とPCパッケージ基板の急減速」について 39
内部要因①：「成長事業における主要顧客層への依存」について 40
内部要因②：「EUV競争環境変化」について 41
内部要因③：「不採算事業の影響」について 42
事業戦略　補足
Industrial Process事業の戦略方針（再掲） 44
成長事業へのリソースシフト（サーマルソリューション分野） 45
成長事業へのリソースシフト（エキシマ分野） 46
High-NA領域での参入に向けた取り組み継続と事業性の見極め 47
安定収益の確保と強固な収益基盤の構築 48
VI事業の戦略方針 49
施策の取り組み内容（VI） 50
LS事業の戦略方針 51
PHS事業の戦略方針 52
ESGへの取り組み　補足
5つの経営のフォーカス（マテリアリティ）と 2030年の目指す姿 54
ガバナンス体制の深化 55

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

Glossary（用語集）

USHIO

IP事業	**IP**	Industrial Process
	Bridge	複数のチップ同士を接続する方法の1つ
	DI	Direct Imaging ： マスクを使わず、直接描画する露光方式
	DI露光装置	DI方式による露光装置
	DLT	Digital Lithography Technology：デジタルリソグラフィ技術
	DRAM	Dynamic Random Access Memory：半導体メモリの一つ
	Epi	Epitaxial growth：エピタキシャル成長
	EUV	Extreme Ultraviolet Radiation：極端紫外放射（極紫外放射）
	FLP	Flash lamp：フラッシュランプ
	FPD	Flat Panel Display ： フラットパネル・ディスプレイ
	High-NA	光の利用効率を高めた次世代のEUV露光技術
	HL	Halogen lamp：ハロゲンランプ
	OA	Office Automation ： オフィス内の事務作業の自動化や効率化を図ること
	OLED	Organic Light Emitting Diode：有機発光ダイオード
	PCB	Printed circuit board：プリント基板
	PKG	Packaging：パッケージング

IP事業	**RDL**	Redistribution layer：再配線層
	インターポーザー	貫通電極による表裏の回路の導通をとり複数のチップ同士をつなぐ基板
	エキシマ	エキシマランプ（Excimer lamp）及びそれを搭載したユニット・装置
	サーマルプロセス	ウエハを高温で加熱する半導体製造工程
	ステッパ	ステップアンドリピート（step and repeat）方式で露光を行う投影露光装置
	デジタルリソグラフィ装置	アプライドマテリアルズ社との業務提携によるDLT(デジタルリソグラフィ技術)搭載のDI露光装置のこと
	半導体アドバンスドパッケージ	チップレットをはじめとする半導体の2xD、3D化に対応する最先端のパッケージ分野
VI事業	**VI**	Visual Imaging
	AVシステムコンサルティング事業	海外子会社で展開している「Nationwide 360 Audio Visual Services」のこと
	DCP	Digital Cinema Projector：デジタル・シネマ・プロジェクター
	ODM	Original Design Manufacturing ： 受託者が製品の設計から製造までを請け負うこと
LS事業	**LS**	Life Science
	Care222	抗ウイルス・除菌用紫外線技術
PHS事業	**PHS**	Photonics Solution
	レーザーモジュール	レーザー光源を生み出すための装置一式
	固体光源	ある固体にエネルギーを供給し、励起されたときに物質特有の光放射をする固体デバイス（例：LED）

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

免責事項

本資料で記述されている将来の当社業績に関する見通しは、現時点で入手可能な情報を基に当社が判断した予想です。
従いまして、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.

未来は光でおもしろくなる

USHIO

＜本資料に関するお問い合わせ先＞

ウシオ電機株式会社 IR室

（03）5657-1007

MAIL: ir@ushio.co.jp

URL: http://www.ushio.co.jp/jp/ir

Copyright (C) 2024 Ushio Inc., All Rights reserved.